

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2003年 2月 6日

出 願 番 号

Application Number:

特願2003-029990

[ST.10/C]:

[JP2003-029990]

出 願 人

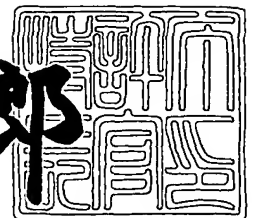
Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2003年 5月 6日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3032004

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0097212

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02B 6/42
H04B 10/12

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 長坂 公夫

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 宮前 章

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 金子 丈夫

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100079108

【弁理士】

【氏名又は名称】 稲葉 良幸

【選任した代理人】

【識別番号】 100080953

【弁理士】

【氏名又は名称】 田中 克郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100093861

【弁理士】

【氏名又は名称】 大賀 眞司

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-192634

【出願日】 平成14年 7月 1日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011903

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9808570

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光トランシーバの製造方法及び調整装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

光ファイバの一端部を保持する光プラグを装着するための嵌合孔を備える光ソケットとこの光ソケットと共に組み立てられる組立対象体とを合わせる第 1 工程と、

前記光ソケットの嵌合孔に前記組立対象体を撮影する光ヘッドを装着し、前記嵌合孔に露出する前記組立対象体の画像と当該撮影画面内の基準位置情報とを得る第 2 工程と、

前記組立対象体の画像と前記基準位置情報とのずれを検出する第 3 工程と、

前記ずれに基づいて前記光ソケットと前記組立対象体とを相対的に移動して前記ずれを減少する第 4 工程と、

前記組立対象体と前記光ソケットとを固定する第 5 工程と、

を含む、光トランシーバの製造方法。

【請求項 2】

前記組立対象体は光透過性の基板又はカンパッケージを含む、請求項 1 に記載の光トランシーバの製造方法。

【請求項 3】

前記組立対象体の画像は、前記組立対象体に形成された配線パターン、位置決め用マーク、位置決め用孔、発光素子、受光素子、レンズ、カンパッケージの窓のうちいずれかを含む、請求項 2 に記載の光トランシーバの製造方法。

【請求項 4】

前記基準位置情報は、撮影された前記画像の画面中心位置を表示するマーカである、請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の光トランシーバの製造方法。

【請求項 5】

前記第 2 工程は、前記光ヘッドと前記組立対象体の間に画像の結像位置を調整する結像位置調整レンズを配置して前記組立対象体の画像を得る、請求項 2 に記載の光トランシーバの製造方法。

【請求項 6】

一端面にアライメントマークが形成された光透過性の柱状体と、
前記柱状体の他端面側に設けられたハウジングと、
前記ハウジング内に設けられて投影された像を画像信号に変換する撮像素子と

前記ハウジング内に設けられて前記柱状体の一端面側を前記撮像素子上に投影するレンズと、
を含む光学ヘッド。

【請求項 7】

更に、
前記撮像素子と前記レンズとの間に設けられたハーフミラーと、
前記ハーフミラーを経由して前記柱状体側に照明光を送る照明光源と、
を備える請求項 6 に記載の光学ヘッド。

【請求項 8】

入射光を反射する反射面を有し、当該反射面と前記レンズの光軸とのなす角度が鋭角となるようにして前記アライメントマークと前記レンズとの間に配置される反射板を更に含む、請求項 6 又は 7 に記載の光学ヘッド。

【請求項 9】

前記反射板は、前記反射面と前記レンズの光軸とのなす角度が略 4 5 度となるように配置される、請求項 8 に記載の光学ヘッド。

【請求項 1 0】

前記反射板は、前記柱状体の他端面側に当該柱状体と一体に構成される、請求項 8 又は 9 に記載の光学ヘッド。

【請求項 1 1】

前記柱状体は、中空の筒状体によって形成される請求項 6 乃至 1 0 のいずれかに記載の光学ヘッド。

【請求項 1 2】

前記柱状体は、光ファイバの束によって形成される請求項 6 乃至 1 0 のいずれかに記載の光学ヘッド。

【請求項 1 3】

前記柱状体は、該柱状体の軸方向の光を集光するレンズを内部に有して形成される請求項 6 乃至 1 0 のいずれかに記載の光学ヘッド。

【請求項 1 4】

光ソケットの支持体に載置された光ソケットの嵌合孔に挿入されてこの嵌合孔の底部付近の対象体を撮影し、この対象体の画像を撮影の基準位置を示す情報と共に読取信号として出力する光学ヘッドと、

前記読取信号を処理して前記対象体と前記基準位置とのずれを検出する画像処理手段と、

前記ずれに応じて前記支持体と前記光ソケットとを相対的に移動して前記ずれを減少する移動手段と、

を備えるアライメント調整装置。

【請求項 1 5】

前記基準位置を示す情報は、撮影された前記画像の画面中心位置を表示するマーカである、請求項 1 4 に記載のアライメント調整装置。

【請求項 1 6】

前記基準位置を示す情報は、撮影された前記画像の画面内の所定位置を表示するマーカである、請求項 1 4 に記載のアライメント調整装置。

【請求項 1 7】

前記基準位置を示す情報は、前記光ソケットの嵌合孔に挿入されて前記対象体と対向する光学ヘッドの柱状体の一端面に形成されるアライメントマークである、請求項 1 4 乃至 1 6 のいずれかに記載のアライメント調整装置。

【請求項 1 8】

前記対象体は、前記支持体に形成された配線パターン、位置決め用マーク、位置決め用穴、発光素子、受光素子、レンズのうちのいずれかを含む請求項 1 4 乃至 1 7 のいずれかに記載のアライメント調整装置。

【請求項 1 9】

前記光ヘッドと前記組立対象体の間に配置され、画像の結像位置を調整する結像位置調整レンズを更に備える、請求項 1 4 乃至 1 8 のいずれかに記載のアライ

メント調整装置。

【請求項 2 0】

前記結像位置調整レンズは前記対象体の表面に配置される、請求項 1 9 に記載のアライメント調整装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、光ファイバを媒体として送信又は受信を行い、あるいは送信及び受信の両方を行う光トランシーバ及びその製造方法に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

ローカルエリアネットワーク（LAN）、コンピュータ装置相互間の直接接続、コンピュータ装置及びデジタルオーディオ・ビデオ機器の相互接続などに、光ファイバを用いるものがある。このような装置には、電気信号を光信号に変えて光ファイバに送ると共に、光ファイバから受けた光信号を電気信号に戻す光トランシーバが使用される。光トランシーバは、例えば、光ファイバの一端部に取り付けられたプラグが挿入されるソケット、該光ファイバの一端部と受光素子や発光素子などの光素子との間に配置されて光を集光するボールレンズと、パラレル信号をシリアル信号に変換して光素子を駆動したり、受光信号を増幅し、シリアル信号からパラレル信号に変換したりする IC 回路基板などから構成されている。

【0 0 0 3】

このような光トランシーバの従来の製造方法は、通常、1) カンパッケージ内にレーザダイオード（LD）チップを実装し、このチップとリード線のボンディングを行う。また、カンパッケージの出射窓にボールレンズを接着し、レンズ付きカンパッケージを組み立てる。2) このカンパッケージを光ソケットの一方の挿入穴に挿入し、他方からファイバ付きフェルールを挿入する。カンパッケージのリード線には LD が発光するように電流を流し、ファイバに結合された光量を測定し、一番結合効率の良い位置でカンパッケージと光ソケットを接着固定する。

(アクティブアライメント)。3) カンパッケージのリード線を回路基板に半田付けする。

【 0 0 0 4 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、このような光トランシーバの製造方法では、構成部品を組み立てる際に三次元的な複雑な位置合わせを行わなければならない、製造工程中に占める手作業の割合が大きい。これは結果的に製品のコストを増大させる。

【 0 0 0 5 】

よって、本発明は、製造工程をより簡易化することを可能とする光トランシーバの製造方法を提供することを目的とする。

【 0 0 0 6 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明の光トランシーバの製造方法は、光ファイバの一端部を保持する光プラグを装着するための嵌合孔を備える光ソケットとこの光ソケットと共に組み立てられる組立対象体とを合わせる第1工程と、上記光ソケットの嵌合孔に上記組立対象体を撮影する光ヘッドを装着し、上記嵌合孔に露出する上記組立対象体の画像と当該撮影画面内の基準位置情報とを得る第2工程と、上記組立対象体の画像と上記基準位置情報とのずれを検出する第3工程と、上記ずれに基づいて上記光ソケットと上記組立対象体とを相対的に移動して上記ずれを減少する第4工程と、上記組立対象体と上記光ソケットとを固定する第5工程と、を含む。

【 0 0 0 7 】

かかる方法によれば、光ソケットと組立対象体との相対的な位置関係を画像処理によって行うことが可能となるので位置調整が簡略化され、位置調整の高速化及び低コスト化を図ることが可能となる。

【 0 0 0 8 】

好ましくは、上記組立対象体は光透過性の基板又はカンパッケージを含む。これにより、各種の構造の光トランシーバに対応可能となる。

【 0 0 0 9 】

好ましくは、上記組立対象体の画像は、上記組立対象体に形成された配線パターン、位置決め用マーク、位置決め用孔、発光素子、受光素子、レンズ、カンパパッケージの窓のうちいずれかを含む。位置決め用マークや位置決め用孔を用いる場合には、調整を行うのに好適な位置や形状等を任意に設定可能となる利点がある。また、配線パターンや発光素子等を用いる場合には、位置決め用マーク等を新たに設けることが不要であり、設計等の手間が軽減されて都合がよい。

【 0 0 1 0 】

好ましくは、上記基準位置情報は、撮影された上記画像の画面中心位置、或いは上記画像の画面内の所定位置を表示するマーカである。

【 0 0 1 1 】

好ましくは、上記第2工程は、光ヘッドと組立対象体の間に画像の結像位置を調整する結像位置調整レンズを配置して組立対象体の画像を得る。それにより、組立対象体の画像をより確実に結像させることが可能となる。

【 0 0 1 2 】

本発明の光学ヘッドは、一端面にアライメントマークが形成された光透過性の柱状体と、上記柱状体の他端面側に設けられたハウジングと、上記ハウジング内に設けられて投影された像を画像信号に変換する撮像素子と、上記ハウジング内に設けられて上記柱状体の一端面側を上記撮像素子上に投影するレンズと、を含む。

【 0 0 1 3 】

かかる光学ヘッドを光ソケット内にセットすると、ソケット底部（基板）とアライメントマークとを同時に見ることができ、光ソケットと基板との位置合わせを行うことが可能となる。

【 0 0 1 4 】

好ましくは、光学ヘッドは、更に、上記撮像素子と上記レンズとの間に設けられたハーフミラーと、上記ハーフミラーを経由して上記柱状体側に照明光を送る照明光源と、を備える。それにより、ソケット底部（基板）を照明して、明るく、画質の良い画像を得て、画像認識の精度向上を図ることが可能となる。

【 0 0 1 5 】

好ましくは、入射光を反射する反射面を有し、当該反射面とレンズの光軸とのなす角度が鋭角となるようにしてアライメントマークとレンズとの間に配置される反射板を更に備える。また、この反射板は、反射面とレンズの光軸とのなす角度が略45度となるように配置するとより好適である。それにより、柱状体の長手方向と異なる方向に上記レンズの光軸を設定することが可能となり、ハウジングの配置スペースの確保や配置位置の設定等の自由度が増す。したがって、より様々な構成態様の光トランシーバに対応可能となる。

【0016】

好ましくは、上記反射板は、柱状体の他端面側に当該柱状体と一体に構成される。それにより、構造の簡略化を図ることが可能となる。

【0017】

好ましくは、上記柱状体は、中空の筒状体によって形成される。それにより、柱状体の内部に他の光学要素等を配置して光路の調整等を行うことが可能となり、装置構成の自由度が増す。

【0018】

好ましくは、上記柱状体は、光ファイバの束によって形成される。それにより、ハウジングの位置を光ソケットから離れた位置に置くことが可能となる。

【0019】

好ましくは、上記柱状体は、該柱状体の軸方向の光を集光するレンズを内部に有して形成される。それにより、撮像素子に像を形成するレンズに至る光量が増加し（開口数NAが増加）撮像の画質が向上する。

【0020】

本発明のアライメント調整装置は、光ソケットの支持体に載置された光ソケットの嵌合孔に挿入されてこの嵌合孔の底部の対象体を撮影し、この対象体の画像を撮影の基準位置を示す情報と共に読取信号として出力する光学ヘッドと、上記読取信号を処理して上記対象体と上記基準位置とのずれを検出する画像処理手段と、上記ずれに応じて上記支持体と上記光ソケットとを相対的に移動して上記ずれを減少する移動手段と、を備える。

【0021】

かかる構成とすることによって、支持体と光ソケットとの位置調整を自動化することが可能となる。また、いわゆるアクティブアライメントを行う場合のように組立対象体に対して電氣的なコンタクトを取る必要がなく、製造装置の簡素化が可能となる利点もある。また、送信側に対応する光ソケットと受信側に対応する光ソケットの双方に対して共通の調整装置によって対応可能となり、調整装置の簡素化及び低コスト化が可能となる。

【 0 0 2 2 】

好ましくは、上記基準位置を示す情報は、撮影された上記画像の画面中心位置、或いは上記画像の画面内の所定位置を表示するマーカである。かかるマーカは撮像素子に投影される実像としてのマーカのみならず、撮像素子の中心部を読み出す際に読取信号中に予め含まれるようになされた電氣的信号として出力される信号マーカであっても良い。

【 0 0 2 3 】

好ましくは、上記基準位置を示す情報は、上記光ソケットの嵌合孔に挿入されて上記対象体と対向する光学ヘッドの挿入部の対物面に形成されるアライメントマークである。

【 0 0 2 4 】

好ましくは、上記対象体は、上記支持体に形成された配線パターン、位置決め用マーク、位置決め用穴、発光素子、受光素子、レンズのうちのいずれかを含む。これ等の形状パターンをアライメント調整の比較用のマークとして利用することができる。

【 0 0 2 5 】

また、上記光ヘッドと組立対象体の間に配置され、画像の結像位置を調整する結像位置調整レンズを更に備えることが好ましい。更に好ましくは、この結像位置調整レンズは上記対象体の表面に配置される。

【 0 0 2 6 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

【 0 0 2 7 】

<第1の実施形態>

図1は、光トランシーバの構成例を示している。同図(a)は光トランシーバ1を水平方向にカットして内部配置を示す断面図、同図(b)は図(a)のI-I'方向における断面図である。

【0028】

図1に示すように、光トランシーバ1の筐体11の内部には、信号処理回路基板12と光結合ユニット13が設けられている。信号処理回路基板12には、外部から供給されるパラレル信号をシリアル信号に変換するパラレルーシリアル信号変換回路121、シリアル信号を発光素子133の駆動信号に変える駆動回路122、受光素子134の受光信号を波形整形し、レベル増幅する増幅回路124、受光信号をパラレル信号に変換するシリアルーパラレル信号変換回路123、図示しないマザーボード等への配線接続と取付けとを行うためのリードフレーム125等が設けられている。

【0029】

光結合ユニット13は、透明なガラス基板131に、配線膜132、発光素子133、受光素子134、結合レンズ135、136等を配置してなる光回路基板130と、図示しない光ファイバの一端に設けられた光プラグと接続される光ソケット137、光回路基板130に光ソケット137を取り付ける接合膜138等によって構成される。光ソケット137（あるいは光結合ユニット13）と光プラグとは光コネクタ（図3参照）を構成する。

【0030】

なお、通常、挿入する側をプラグ、挿入される側をソケットと称しているが、本件の説明においては、単に、コネクタを構成する一方側(光線路側)をプラグ、他方側(基板側)をソケットと称しており、雌雄の形状に限定されるものではない。

【0031】

図2は、図1(a)に示された光結合ユニット13の部分を拡大して説明する図である。図2(a)は、プラグ挿入孔側から光結合ユニット13側を見た図を示しており、同図(b)は、光結合ユニット13の断面図である。各図において

図1と対応する部分には同一符号を付し、かかる部分の説明は省略する。

【 0 0 3 2 】

光回路基板 1 3 0 は、光信号を透過させる透明基板 1 3 1、この透明基板 1 3 1 の内側（筐体内部側）表面に形成された配線パターン 1 3 2、この配線パターン 1 3 2 に接続される発光素子 1 3 3（又は受光素子 1 3 4）、透明基板 1 3 1 の外側（光プラグ側）表面に配置された結合レンズ 1 3 5 を含んでいる。発光素子 1 3 3 は、例えば、レーザビームを発生する面発光レーザ（VCSEL）である。受光素子 1 3 4（図 1（a）参照）は、フォトトランジスタやフォトダイオードなどの受光光量に応じた電流を発生する光検出素子である。光ソケット 1 3 7 の、光プラグの光ファイバを保持するフェルール（後述の図 3 参照）が挿入されるスリーブ 1 3 7 a は環状あるいは円筒状に形成される。フェールの挿入を案内するスリーブ 1 3 7 a の嵌合孔 1 3 7 b の底部中央は開口部 1 3 7 c となっている。この開口部 1 3 7 c に、基板 1 3 1 に形成された結合レンズ 1 3 5（又は 1 3 6）が露出している。嵌合孔 1 3 7 b は、光ソケット 1 3 7 を貫通する孔となっている。

【 0 0 3 3 】

図 3 は、光ソケット 1 3 7 に光プラグ 2 0 0 が取り付けられた状態を示している。光ソケット 1 3 7 の円筒状のスリーブ 1 3 7 a 内に光プラグ 2 0 0 の円柱状のフェルール 2 0 2 が挿入され、フェルール 2 0 2 はプラグハウジング 2 0 1 によって保護されている。光ソケット 1 3 7 と光プラグ 2 0 0 とは、図示しない係止手段によって固定される。係止手段は、例えば、プラグハウジング 2 0 1 に設けられた開閉可能なフックと光ソケット 1 3 7 に設けられた該フックに係合するスタッドである。フェルール 2 0 2 は光ファイバ 2 0 3 の端部を保持し、スリーブ 1 3 7 a の円筒内部に挿入されることによって、該円筒の中心軸上に光ファイバ 2 0 3 の中心軸（光軸）を保持する。光ファイバ 2 0 3 の線路部分は被覆 2 0 4 によって保護されている。光ファイバ 2 0 3 のコアから放射された光はスリーブ 1 3 7 a の底部の開口部 1 3 7 c に設けられている結合レンズ 1 3 6、透明基板 1 3 1 を経て受光素子 1 3 4 上に収束（あるいは集光）される。また、発光素子 1 3 3 から出射された光は透明基板 1 3 1、結合レンズ 1 3 5 を経て、光ファ

イバ203端部のコア部分に収束される。

【0034】

図4は、他の光結合ユニット（光コネクタ）13の例を示している。図4において、図2と対応する部分には同一部号を付し、かかる部分の説明は省略する。

【0035】

上述の図2に示した例では、送信用及び受信用に別々の光ファイバを使用し、1つの光コネクタが2本の光ファイバを接続するものとなっている。この図4に示す例では、送信用又は受信用、あるいは送受信用の1つの光ファイバ毎に1つの光結合ユニット（光コネクタ）を設ける構成としている。

【0036】

次に、上述した光トランシーバの製造について図面を参照して説明する。図5は、実施例の光トランシーバの製造工程を説明する工程図である。

【0037】

まず、光回路基板130を作製するために、図5（a）に示すように、光透過基板としてガラス基板131を用意する。次に、図5（b）に示すように、ガラス基板131の表面にアルミニウムや銅等の導電材料をスパッタ法、電鍍などによって堆積し、金属膜（導電膜）を形成する。この金属膜を所望の回路に対応してパターニングして配線膜132を形成する。

【0038】

図7は、ガラス基板131の複数のサブ領域Sにそれぞれ複数の金属配線膜パターン132を形成した例を示している。

【0039】

図5（c）に示すように、ガラス基板131の一面側に、発光素子133（あるいは受光素子134）、集積回路等の回路要素を実装する。実装は、フリップチップボンディング、ワイヤボンディング、半田リフローなどを使用して行うことが可能である。

【0040】

図5（d）に示すように、ガラス基板131の他面側の発光素子133（あるいは受光素子134）に対応する位置に結合レンズ135（あるいは136）を

形成する。結合レンズ135（あるいは136）の形成は、レンズ状の部材の張り合わせ、硬化性液体樹脂の表面張力を利用したレンズ形成、更に、後述のレンズの型と2P法を組み合わせたレンズ形成などによって行うことも可能である。このようにして光回路基板130が作製される。

【0041】

次に、図5（e）に示すように、光ソケット137を光回路基板130に取り付ける。この取付は、光ソケット137とガラス基板131の互いに対向する面にそれぞれ接着剤を塗布し、あるいはいずれかの面に接着剤を塗布して光ソケット137を光回路基板130に取り付ける。光ソケット137は、そのスリーブ137aの円筒状の嵌合孔137bの中心軸が結合レンズ135（又は136）及び発光素子133（又は134）の中心位置と略一致するように載置される。この際の光ソケット137と光回路基板130との位置合わせ（粗調整）は、基板130の図示しないマーカやレンズ位置等を参照して行うことが可能である。

【0042】

更に、図6（a）に示すように、光ソケット137と光回路基板130との正確な位置合わせを行う。正確な位置合わせには、例えば、位置調整装置300を使用する。位置調整装置300は、後述のアライメントマークと対象体とを讀取る光学ヘッド310、画像処理によってアライメントマークと対象体との位置ずれを検出するコンピュータシステム320、コンピュータシステム320によってずれを補償するように駆動されるアクチュエータ330、アクチュエータに取り付けられてガラス基板131または光学ヘッド310を取付位置に搬送するアーム（ステージ）等によって構成されている。光学ヘッド310は、光ソケット137の嵌合孔137b内にフェルール（讀取部）を挿入し、嵌合孔137bの中心位置を示すアライメントマークと、対象体、例えば、基板の特定の回路パターンや調整用マークなど讀取る。この結果に基づいて、光ソケット137の嵌合孔137bの中心軸が結合レンズ135及び光素子133（あるいは結合レンズ136及び光素子134）の中心位置（光軸）と正確に一致するように位置合せ（微調整）を行う。光ソケット137に光プラグ200が装着されると、嵌合孔137bの中心軸には、フェルール202に支持された光ファイバ203のコアが

位置する。この位置調整装置300については更に後述する。

【0043】

図6(b)に示すように、光ソケット137と光回路基板130との位置合わせを終えた後に、接着剤138を固化して光ソケット137を光回路基板130に固定する。接着剤138は、例えば、光硬化性、熱硬化性等等樹脂を用いることが可能である。

【0044】

図5(e)、図6(a)及び同(b)の工程を必要な回数繰り返して、図8に示すように、光回路基板130の複数のサブ領域Sに光ソケット137を取付けて光トランシーバを組み立てる。このようにして組み立てた基板130をサブ領域S毎に切断線Wに沿って切断して多数の光トランシーバを得る。

【0045】

図9は、光ソケット137の取付位置調整を行うために工夫された調整装置(光学ヘッド)の例を説明する説明図である。同図において図2と対応する部分には同一符号を付し、かかる部分の説明は省略する。

【0046】

光学ヘッド310は、光ソケット137のスリーブ137aの嵌合孔(案内溝)137bに挿入される、光を透過する円柱状部材のフェルール311と、このフェルール311の上端部に配置されたハウジング部312とを含む。フェルール311の下端面には、フェルールアライメントマーク313が形成されている。ハウジング部312内にはマークを読取るCCD撮像素子314、CCD撮像素子314上にフェルールアライメントマーク313や基板上的アライメントマーク(図10参照)の読取り像を形成するレンズ315、必要によりフェルール311の下端面側を照明するLED、水銀ランプ等の照明光源316、照明光源316の光をフェルール311側に導くハーフミラー317を含んでいる。

【0047】

かかる構成によって、照明光源316によってスリーブ137aの嵌合孔137b底部が照明され、該底部の画像がフェルールアライメントマーク313と共にCCD撮像素子314によって読取られる。

【0048】

かかる光学ヘッド310を用いる光ソケット137の取付位置調整について説明する。まず、光学ヘッド310のフェルール311がスリーブ137a内に隙間なく挿入される。それにより、CCD撮像素子314によって図10に示すような撮影画像が得られる。フェルールアライメントマーク313が嵌合孔137bの中央部（円筒部311の下端面の中心位置）あるいは画面314aの中央部に位置する。上述したように、照明光源316によって嵌合孔137bの底部を照明し、面発光レーザ133上のアライメントマーク132aとフェルールアライメントマーク313とを照射する。アライメントマーク132aは、光ソケット137の取付調整のために特に用意された位置合わせマークの他、例えば、発光素子133の発光部や受光素子134の受光部の形状、発光素子133や受光素子134の取り付け用に用意されたアライメントマーク、電極や配線パターン、取り付けられた部品等をアライメントマークとして利用することが出来る。これ等は対象体としてCCD撮像素子314による撮影の対象とされる。アライメントマークを照射した光は反射してレンズ315に入射し、集光されてCCD撮像素子314に各アライメントマークの像を形成する。CCD撮像素子314は、多数の読取り画素を配列してアライメントマーク像を画像信号に変換する。この信号をコンピュータシステム320によって画像処理し、各アライメントマークの位置を判別し、両アライメントマークが重なるように、光ソケット137の位置を基板130に対して相対的に移動する（図6（a）参照）。図10に示す例では、光回路基板130と光ソケット137とを相対的に適宜移動して、基板上の「C」状のアライメントマーク132aの中心位置がフェールのアライメントマーク313と重なるようにする。その後、接着剤138を固化させる。光ソケット137が複数のスリーブ137aを備えて、複数の光ファイバを接続するものである場合には、少なくとも2箇所のスリーブ137aの嵌合孔137bで上述の位置合わせを行うことで複数光ファイバ端子の光ソケットの取付位置調整を行うことが可能である。

【0049】

このようにして、1つの光軸318上に光素子133、134、結合レンズ1

35、136、光ファイバ203を揃えることができ、光コネクタにおける接続ロスを減ずることが可能となる。なお、上述した調整方法は、従来のカンパッケージに光ソケットを取り付ける場合においても適用することが可能である。

【0050】

光ヘッド310の他の構成例について図面を参照して説明する。

【0051】

図11は、光ヘッド310のフェルール311の他の構成例を示している。フェルール311は、上述した図9に示すような円柱状のものみならず、図11に示すように、中空の円筒状の部材を用いて構成しても良い。

【0052】

図12は、光ヘッド310のフェルール311の他の構成例を示している。同図において図9と対応する部分に同一符号を付し、かかる部分の説明は省略する。

【0053】

この例では、中空の円筒状の部材を用いて構成したフェルール311内に更に小型レンズ311aを設けている。このレンズ311aによってアライメントマーク313や基板130からの反射光をレンズ315の光軸318に対して平行な光線とし、CCD撮像素子318に入射する光線、光量を増加する。これは光学系の開口数NAを等価的に増加することになり、撮影画像の画質の向上が図られる。

【0054】

図13は、光ヘッド310のフェルール311の他の構成例を示している。同図において図9と対応する部分に同一符号を付し、かかる部分の説明は省略する。

【0055】

この例では、フェルール311部分を多数の光ファイバの束311bによって構成している。このような構成によれば、可撓性の光ファイバによってハウジング312の位置を光回路基板130の位置から離間させ、所望の位置や姿勢に置くことが可能となる。

【0056】

図14は、光回路基板のレンズ135、136の他の形成例を説明する図である。この例では、金型を使用してレンズ形成を行っている。

【0057】

まず、図14(a)に示すように、光回路基板130に、光硬化性樹脂又は熱硬化性樹脂、例えば、紫外線を照射することによって硬化する光硬化性接着剤138を塗布した光ソケット137を位置合わせして（粗調整）暫定的に取り付ける。光ソケット137のスリーブ137a内に円柱状の金型401を嵌合孔137bに沿って挿入する。この金型401の先端部には、結合レンズ135（あるいは136）に対応した形状が形成されている。金型401を嵌合孔137bに沿って押し込むと、嵌合孔137b内の樹脂138が当該型部分に集まる。なお、光硬化性接着剤138を型部分に塗布してスリーブ137aの嵌合孔137bに挿入することとしても良い。金型401の先端部と、スリーブ137aの壁と、光回路基板130のガラス基板面とによって画定される部分の空間形状は屈折レンズやフレネルレンズ等の形状となる。円柱状の金型401の中心軸と当該レンズの中心軸（光軸）は一致する。

【0058】

この状態で必要により、金型401と光ソケット137とをガラス基板131に対して相対的に移動させてレンズの中心に基板の光学素子のアライメントマーク（例えば、電極や配線パターン等）に正確に位置合わせを行う（微調整）。例えば、光回路基板130の光素子側からカメラでガラス基板131を通して金型401を見ることによって基板130のアライメントマークと金型のパターンとを比較して両者の位置調整を行うことが可能である。

【0059】

次に、図14(b)に示すように、紫外線を照射して接着剤138を固化させ、光ソケット137の基板130への固定とレンズ135の形状の固定化とを図る。その後、金型401を引き抜く。

【0060】

この例では、金型401を使用してレンズ形成と光ソケットの取り付けとを同

じ工程で行うので、上述した、図5(d)乃至図6(a)のレンズ取り付け、光ソケット取付け、アライメント調整の各工程を同時に行うことが可能となる。

【0061】

図15は、他の実施例を示している。図15(a)はこの実施例の光結合ユニット部13を光プラグの挿入口側から見た説明図である。同図(b)は、光結合ユニット13の断面図である。両図において図2と対応する部分には、同一符号を付し、かかる部分に説明は省略する。

【0062】

この実施例では光ソケット137と光回路基板130との取り付け強度を高めている。また、光ソケット137の光回路基板130への取付け精度を確保しつつ組み立てを容易にしている。

【0063】

このため、本実施例では、図15(a)及び同図(b)に示すように、光ソケット137の少なくとも2箇所に突起(ガイドピン)137dが形成されている。これ等ガイドピン137dは、これ等のガイドピン137dに対応してガラス基板130に形成されたガイド穴131aに挿入されている。

【0064】

この実施例の組み立て工程においては、図16に示すように、ガラス基板131には、予め所定の位置に所定の径のガイド穴131aがフォトリソグラフィなどによって高精度に形成される。光素子及び結合レンズはこのガイド穴131aを基準にして所定の位置に取り付けることもできる。このガラス基板131に配線パターン132を形成し、部品の装着を行って(図9参照)、光ソケット137の取付を行う(図10参照)。

【0065】

光ソケット137はガイド穴131aの中心を基準として所定の位置に所定の深さのガイドピン137dを精密に形成する。この光ソケット137のガイドピン137dと基板131のガイド穴131aとを嵌め合わせて基板131にソケット137を取付ける。更に、ガイドピン137dと基板131とを接着剤138で接着することによって両者が強固に固定される。

【0066】

また、結合レンズを内蔵した光ソケットを用いて光トランシーバを構成することも可能である。

【0067】

図17及び図18は、レンズ内蔵型の光ソケットを用いる実施例について説明する図である。図17及び図18では、レンズ内蔵型の光ソケット437に光プラグ200が取り付けられた状態が示されている。両図において図3と対応する部分には、同一符号を付し、かかる部分の説明は省略する。

【0068】

図17に示す光ソケット437は、結合レンズ435を内蔵している。そして、図17に示す実施例では、上述した実施例において透明基板131の内側表面に配置されていた結合レンズ135が省略されている。

【0069】

光ソケット437の円筒状のスリーブ437a内に光プラグ200の円柱状のフェルール202が挿入され、フェルール202はプラグハウジング201によって保護されている。光ソケット437と光プラグ200とは、図示しない係止手段によって固定される。係止手段は、例えば、プラグハウジング201に設けられた開閉可能なフックと光ソケット437に設けられた該フックに係合するスタッドである。光ファイバ203のコアから放射された光はスリーブ437aに内蔵されているレンズ435、透明基板131を経て受光素子134上に収束（あるいは集光）される。また、発光素子133から出射された光は透明基板131、レンズ結合レンズ435を経て、光ファイバ203端部のコア部分に収束される。

【0070】

図18に示す光ソケット437'は、上述した図17に示した光ソケット437と同様の構造を有しており、少なくとも2箇所にガイドピン437dが形成された点が異なっている。これ等ガイドピン437dは、これ等のガイドピン437dに対応してガラス基板130に形成されたガイド穴131aに挿入されている。この実施例では、上述した図15等において説明した実施例と同様に、光ソ

ケット437と光回路基板130との取り付け強度を高めることが可能となり、かつ光ソケット437の光回路基板130への取付け精度を確保しつつ組み立てを容易にすることが可能となる。

【0071】

図17に示す光ソケット437あるいは図18に示す光ソケット437'を用いた場合の光トランシーバの製造工程は、基本的に、上述した図5等において説明した実施例と同様であるが、透明基板131上に結合レンズ135を形成する必要がなくなることから、製造工程を簡略化することが可能となる。

【0072】

図19及び図20は、本発明の利点を説明するための比較例の光トランシーバを示している。図19は、比較例の光トランシーバの筐体の断面図であり、図1(b)と対応する部分には同一符号を付し、かかる部分の説明は省略する。

【0073】

比較例においても、外部から回路基板121にリードフレーム125を介して電気信号が供給される。回路基板121には、並直列変換回路12、レーザダイオードを駆動する駆動回路122などが実装されている。レーザダイオードは金属のカンパッケージ501内に実装されている。レーザダイオードから出射したビームはカンパッケージ501の窓に取り付けられたボールレンズ502で集光され、光ソケット137のスリーブの挿入孔中心部に集光する。

【0074】

図20は、比較例の光コネクタ部分を示している。光プラグ200の中心部には光ファイバ203を中心に固定したフェルूल202が挿入されている。光プラグ200をソケット137に接続すると、ボールレンズ502で集光された光が光ファイバ203のコアの中心に入射する。

【0075】

このような比較例の構成では、カンパッケージ501内へのレーザダイオードチップの取付け、該チップとリード線とのボンディング、カンパッケージ窓へのボールレンズの接着、レンズ付きカンパッケージの組立てなどの工程が必要となる。更に、このカンパッケージをソケットのスリーブの一方の穴に挿入し、他方

からファイバを支持するフェルールを挿入し、レーザダイオードを発光させて一番効率よく、光が伝送する位置でカンパッケージとスリーブとを接着して固定する。その後、カンパッケージのリード線を回路基板に半田付けして終了する。

【 0 0 7 6 】

このような構成の比較例の光トランシーバは、三次元的な構造をしているため、構成部品を組み立てる際には、複雑な位置合わせをしなければならない。これに対して、本発明の実施例によれば、光透過性の基板を利用して光トランシーバを形成しているので、略二次元的な位置合わせで組立てを行うことが可能となって具合がよい。

【 0 0 7 7 】

以上説明したように、本発明の実施例によれば、光トランシーバの光結合ユニットを透明基板の一面側に配線と光素子を配置し、該基板の他面側に結合レンズとスリーブを配置する構成によって得ている。かかる構成とすることによって、一枚の基板上に配線パターンや結合レンズのセットを多数組形成し、これをサブ基板に切り出すことによって製造することができ、量産工程にむく。

【 0 0 7 8 】

また、位置調整装置のフェルールアライメントマークを基板のアライメントマーク上に重なるようにして固着前のスリーブとレンズの位置とを手動又は自動で二次元に移動して合わせればよく、簡単で自動化にも向く。

【 0 0 7 9 】

また、ガラス基板をスライドさせながら素子やスリーブの実装を連続的に高速で行える。

【 0 0 8 0 】

また、ガラス基板をスライドさせながら個々の仮結合ユニットの検査、面発光レーザ（VCSEL）の出力調整、発光ダイオード（PD）の感度調整が可能となる。

【 0 0 8 1 】

また、実施例の光学ヘッドを用いた調整方法によれば、CCD撮像素子で撮像することにより、例えば、フェルールアライメントマークと発光素子又は受光素

子上のアライメントマークの相対的な位置関係を画像処理によって正確に検出できるので、位置検出と移動のループ回数を少なくすることで高速な位置決めが可能となる。

【 0 0 8 2 】

このようにして、従来の個別にパーツの実装や組立を行う方式と比較して、大きくコストダウンが可能となる。

【 0 0 8 3 】

<第2の実施形態>

図 2 1 及び図 2 2 は、第 2 の実施形態の光トランシーバの構成を説明する図である。図 2 1 及び図 2 2 では、本実施形態の光トランシーバが部分的に断面図にして示されている。図 2 1 に示す光トランシーバ 7 0 0 は、光ファイバ 7 5 1 の一端部に設けられた光プラグ 7 5 0 を取付けるための光ソケット 7 0 1 と、光を集光する集光手段としての結合レンズ 7 0 3 と、供給される電気信号に応じて発光する VCSEL 等の発光素子又は供給される受光信号に応じて電気信号を発生する受光素子からなる光素子 7 0 4 と、光ファイバ 7 5 1、結合レンズ 7 0 3 及び光素子 7 0 4 が 1 つの光軸上に揃うように光ソケット 7 0 1、結合レンズ 7 0 3 及び光素子 7 0 4 をそれぞれ支持する光透過性の基板 7 0 5 を含んで構成されている。

【 0 0 8 4 】

そして、本例では、光ファイバ 7 5 1 の延在方向と基板 7 0 5 とが略平行となるように光ソケット 7 0 1 が基板 7 0 5 上に配置されており、光素子 7 0 4 から出力される光又は光ファイバ 7 5 1 から出射される光の進路を略 9 0 度変更する反射板 7 0 6 が光ソケット 7 0 1 の一方端側に配置されている。光ソケット 7 0 1 の内部には矩形状の断面を有する嵌合孔（案内溝）が形成されており、この嵌合孔に光プラグ 7 5 0 が挿入されている。また本例では、光プラグ 7 5 0 の一方端に光ファイバ 7 5 1 から出射される光又は光素子 7 0 4 から出射される光を集光する結合レンズ 7 5 2 が設けられている。

【 0 0 8 5 】

また、図 2 2 に示す光トランシーバ 7 0 0 a は、基本的に図 2 1 に示す光トラ

ンシーバ 7 0 0 と同様の構成を有しており、光プラグ 7 5 0 の一方端の結合レンズアレイ 7 5 2 が省略され、結合レンズ 7 0 3 a 及び反射板 7 0 6 を介して、光素子からの出射光を光ファイバ 7 5 1 の端面に導き、或いは光ファイバ 7 5 1 からの出射光を集光して光素子 7 0 4 に導く構成としている。

【 0 0 8 6 】

このように、本発明において「1つの光軸」とは直線状の場合以外にも、図 2 1 又は図 2 2 に示す例のように方向が途中で変わっている場合も含み、その場合であっても上記したような本発明の作用効果を奏することが可能である。

【 0 0 8 7 】

次に、上述した光トランシーバの製造について図面を参照して説明する。本例の光トランシーバの製造方法は、基本的には上述した第 1 の実施形態の場合（図 5 参照）と同様であるため、重複する部分については適宜省略して説明を行う。

【 0 0 8 8 】

図 2 3 は、第 2 の実施形態の光トランシーバの製造工程を説明する工程図である。まず、図 2 3 (a) に示すように、光透過基板としてガラス基板 7 0 5 を用意する。次に、ガラス基板 7 0 5 の表面にアルミニウムや銅等の導電材料をスパッタ法、電鍍などによって堆積し、金属膜（導電膜）を形成する。この金属膜を所望の回路に対応してパターニングすることにより、図 2 3 (b) に示すようにガラス基板 7 0 5 の表面に配線膜 7 0 7 を形成する。なお、上述した図 7 の場合と同様に、ガラス基板 1 3 1 の複数のサブ領域にそれぞれ複数の配線膜（金属配線膜パターン） 7 0 7 を形成してもよい。

【 0 0 8 9 】

次に、図 2 3 (c) に示すように、ガラス基板 1 3 1 の一面側に、光素子（発光素子あるいは受光素子） 7 0 4 やその他の回路要素（集積回路等）を実装する。実装は、フリップチップボンディング、ワイヤボンディング、半田リフローなどを使用して行うことが可能である。

【 0 0 9 0 】

次に、図 2 3 (d) に示すように、ガラス基板 7 0 5 の他面側に、後に光ソケット 7 0 1 を固定するために用いる紫外線硬化樹脂 7 2 0 を塗布する。なお紫外

線硬化樹脂 720 に代えて、熱硬化性の樹脂等などを用いることも可能である。
またこのとき、紫外線硬化樹脂 720 の一部をスタンプ 721 によって成型することにより、光素子 704 に対応する位置に結合レンズ 703 を形成する。

【0091】

次に、図 23 (e) に示すように、紫外線硬化樹脂 720 を介して光ソケット 701 をガラス基板 705 に取り付ける。このとき、光ソケット 701 は、上述した第 1 の実施形態と同様の位置調整装置 300 と、本例の光トランシーバ 700 に好適に構成された光学ヘッドを用いて正確な位置合わせがなされて取り付けられる。光学ヘッドの構成例と、当該光学ヘッドを用いて行われる位置調整の詳細については後述する。

【0092】

次に、紫外線硬化樹脂 720 を固化して光ソケット 701 をガラス基板 705 に固定し、図 23 (f) に示すように、光ソケット 701 が取り付けられたガラス基板 705 を所定領域毎に切断する。これにより、多数の光トランシーバ 700 が得られる。

【0093】

図 24 は、上述した図 23 (e) に示した工程において用いられる光学ヘッドの構成例を説明する図である。同図に示す光学ヘッド 800 は、プローブ（フェルール）801、ハウジング部 802、支持体 803、CCD 撮像素子 804、レンズ 805、照明光源 806、ハーフミラー 807 を含んで構成されている。

【0094】

プローブ 801 は、位置調整時に光ソケット 701 の嵌合孔（案内溝）701a に挿入される柱状の部位であり、光を透過するガラス等の材料によって形成されている。このプローブ 801 の一端側には、入射光を反射してその進路を略 90 度変更する反射部 808 が設けられ、他端側（光ソケット 701 に挿入される側）には、位置調整に用いられるアライメントマーク 809 が設けられている。

【0095】

ハウジング部 802 は、CCD 撮像素子 804 やレンズ 805 などの光学要素を支持するものであり、上記プローブ 801 の端部側であって、上記反射部 80

8によって反射される光を受け得る位置に配置されている。

【0096】

支持体803は、略L字状の部材であり、図示のようにプローブ801の光軸（長手方向）とハウジング部802内の光学要素の光軸とが略直交するように当該プローブ801及びハウジング部802を支持する。支持体803の一部は、プローブ801と共に光ソケット701に挿入される。

【0097】

CCD撮像素子804は、上記プローブ801等を含んでなる光学系を介して伝搬される光を電気信号（画像信号）に変換するものであり、上記アライメントマーク809等の読み取りに用いられる。レンズ805は、CCD撮像素子804上にアライメントマーク809や基板側に設けられるアライメントマーク（後述する）の読取り像を形成する。

【0098】

照明光源806は、必要によりプローブ801の他方端側を照明するためのものであり、LED、水銀ランプ等が用いられる。ハーフミラー807は、照明光源806から出射される光をプローブ801側に導く。ハーフミラー807によって導かれた光は、プローブ801の一方端の反射部808によって反射され、プローブ801の他方端へ進行する。かかる構成によって、照明光源806によってガラス基板705の光素子704が配置される領域近傍が照明され、当該領域の画像がアライメントマーク809と共にCCD撮像素子804によって読取られる。

【0099】

次に、図24に示す光学ヘッド800を用いた光ソケット137の取付位置調整について説明する。まず、光学ヘッド800のプローブ801が嵌合孔701a内に隙間なく挿入される。それにより、CCD撮像素子804によって図25に示すような撮影画像が得られる。本例では、嵌合孔701aの奥側（図中右側）が「底部」に対応する。また、反射板706を介してガラス基板705の光素子704が実装されている位置及びその近傍の画像を撮影することにより、「底部付近の対象体」としての基板側のアライメントマーク710の画像を得ている

【0100】

また、上述したように、照明光源806によりガラス基板705側に設けられるアライメントマーク710とプローブ801の端部のアライメントマーク809とを照射する。なお、本例におけるアライメントマーク710は光素子704を構成する素子チップに設けられているが、このように光ソケット701の取付調整のために特に用意された位置合わせマークの他、例えば、光素子704の形状、光素子704の取り付け用に用意されたアライメントマーク、電極や配線パターン、取り付けられた部品等をアライメントマークとして利用することも可能である。これ等は対象体としてCCD撮像素子804による撮影の対象とされる。

【0101】

アライメントマークを照射した光は反射し、光トランシーバ700の反射板706で反射し、プローブ801を通過して当該プローブ801の端部の反射部808で反射してレンズ805に入射し、集光されてCCD撮像素子804に各アライメントマークの像を形成する。CCD撮像素子804は、多数の読取り画素を配列してアライメントマーク像を画像信号に変換する。この信号をコンピュータシステム320（図6参照）によって画像処理し、各アライメントマークの位置を判別し、両アライメントマークの位置関係が所定の状態となるように、光ソケット701の位置をガラス基板705に対して相対的に移動する。図25に示す例では、ガラス基板705と光ソケット701とを相対的に適宜移動して、光素子704の十字状のアライメントマーク710が、4つの点からなるプローブ801のアライメントマーク809に囲まれる領域内に入るように位置調整がなされる。このようにして、1つの光軸808上に結合レンズ703、光素子704、光ファイバ751を揃えることができ、光コネクタにおける接続ロスを低減することが可能となる。

【0102】

ところで、本実施形態の調整方法では、ガラス基板705側のアライメントマーク710の像をプローブ801の先端に確実に結像させる（焦点を結ばせる）

ことが重要である。このため、ガラス基板 7 0 5 側のアライメントマーク 7 1 0 とプローブ 8 0 1 との間に当該アライメントマーク 7 1 0 の像の結像位置を調整するためのレンズを配置することによって、更に具合よく調整を行うことが可能となる。以下、その詳細について説明する。

【 0 1 0 3 】

図 2 6 及び図 2 7 は、アライメントマーク 7 1 0 の像の結像位置を調整するためのレンズの構成例を説明する図である。図 2 6 及び図 2 7 は、共にガラス基板 7 0 5 の光素子 7 0 4 の実装位置の近傍を上面側（結合レンズ 7 0 3 の形成面側）から見た平面図を示している。

【 0 1 0 4 】

図 2 6 に示す例では、ガラス基板 7 0 5 の裏面側に光素子 7 0 4（図中において点線で表示）が横方向に 4 つ並べて配置された素子チップが実装されており、これら 4 つの光素子 7 0 4 の上側に 2 つのアライメントマーク 7 1 0 が配置されている。また、ガラス基板 7 0 5 の表面側には、各光素子 7 0 4 のそれぞれに対応して 4 つの結合レンズ 7 0 3 が配置され、更に 2 つのアライメントマーク 7 1 0 のそれぞれに対応して 2 つのマーク結像レンズ（結像位置調整レンズ） 7 1 1 が配置されている。このマーク結像レンズ 7 1 1 は、アライメントマーク 7 1 0 の像がプローブ 8 0 1 の先端面に結像するように設計されている。

【 0 1 0 5 】

また、図 2 7 に示す例では、ガラス基板 7 0 5 の裏面側に 4 つの光素子 7 0 4 が実装されており、これら 4 つの光素子 7 0 4 の左右の両側に 2 つのアライメントマーク 7 1 0 が配置されている。また、ガラス基板 7 0 5 の表面側には、各光素子 7 0 4 のそれぞれに対応して 4 つの結合レンズ 7 0 3 が配置され、更に 2 つのアライメントマーク 7 1 0 のそれぞれに対応して 2 つのマーク結像レンズ 7 1 1 が配置されている。

【 0 1 0 6 】

本実施形態では、各結合レンズ 7 0 3 と各マーク結像レンズ 7 1 1 は、それぞれ回折型レンズによって構成されている。回折型レンズとすることにより、多種類のレンズを任意のサイズ、位置にレイアウトすることが容易となり都合がよい

。なお、屈折型レンズ等を用いて結合レンズ 7 0 3 等を形成してもよい。

【0107】

このように、結像位置調整レンズを用いることにより、ガラス基板 7 0 5 側に設けられるアライメントマーク 7 1 1 の像とプローブ 8 0 1 の先端に配置されるアライメントマーク 8 0 9 とを同時に（すなわち同じ撮像条件にて）撮像することが可能となり、位置調整の更なる容易化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 図 1 は、本発明の光トランシーバの実施の形態を説明する説明図である。

【図 2】 図 2 は、2 組の端子を有する光ソケット部分を説明する説明図である。

【図 3】 図 3 は、光ソケットと光プラグとの接続状態を説明する説明図である。

【図 4】 図 4 は、1 組の端子を有する光ソケット部分を説明する説明図である。

【図 5】 図 5 は、光トランシーバの製造工程を説明する工程図である。

【図 6】 図 6 は、光トランシーバの製造工程に置け光ソケットの配置位置調整を説明する工程図である。

【図 7】 図 7 は、基板への配線パターンの形成例を説明する説明図である。

【図 8】 図 8 は、基板への光ソケットの取り付け例を説明する説明図である。

【図 9】 図 9 は、光ヘッドの例を説明する説明図である。

【図 1 0】 図 1 0 は、撮像素子に読取られた画像の例を説明する説明図である。

【図 1 1】 図 1 1 は、光ヘッドのフェルールの他の構成例(筒状体)を説明する説明図である。

【図 1 2】 図 1 2 は、光ヘッドのフェルールの他の構成例(レンズ内臓)を説明する説明図である。

【図 13】 図 13 は、光ヘッドのフェルールの他の構成例(光ファイバ使用)を説明する説明図である。

【図 14】 図 14 は、光ソケットの嵌合孔に金型を入れてレンズを形成する例を説明する説明図である。

【図 15】 図 15 は、基板と光ソケットにそれぞれ取付用孔及び取付用突起を設けて組み立てる例を説明する説明図である。

【図 16】 図 16 は、基板に取付用孔を形成する例を説明する説明図である。

【図 17】 図 17 は、レンズ内蔵型の光ソケットを用いる実施例について説明する図である。

【図 18】 図 18 は、レンズ内蔵型の光ソケットを用いる実施例について説明する図である。

【図 19】 図 19 は、比較例の光トランシーバの例を説明する説明図である。

【図 20】 図 20 は、比較例の光コネクタの例を説明する説明図である。

【図 21】 図 21 は、第 2 の実施形態の光トランシーバの構成を説明する図である。

【図 22】 図 22 は、第 2 の実施形態の光トランシーバの構成を説明する図である。

【図 23】 図 23 は、第 2 の実施形態の光トランシーバの製造工程を説明する工程図である。

【図 24】 図 24 は、光学ヘッドの構成例を説明する図である。

【図 25】 図 25 は、撮影画像の例を説明する図である。

【図 26】 図 26 は、アライメントマークの像の結像位置を調整するためのレンズの構成例を説明する図である。

【図 27】 図 27 は、アライメントマークの像の結像位置を調整するためのレンズの構成例を説明する図である。

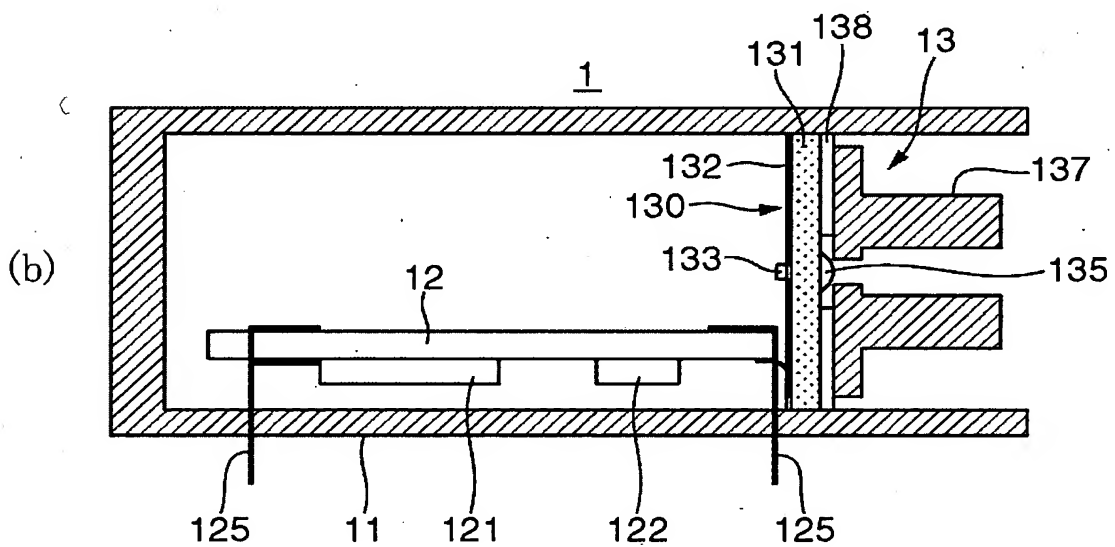
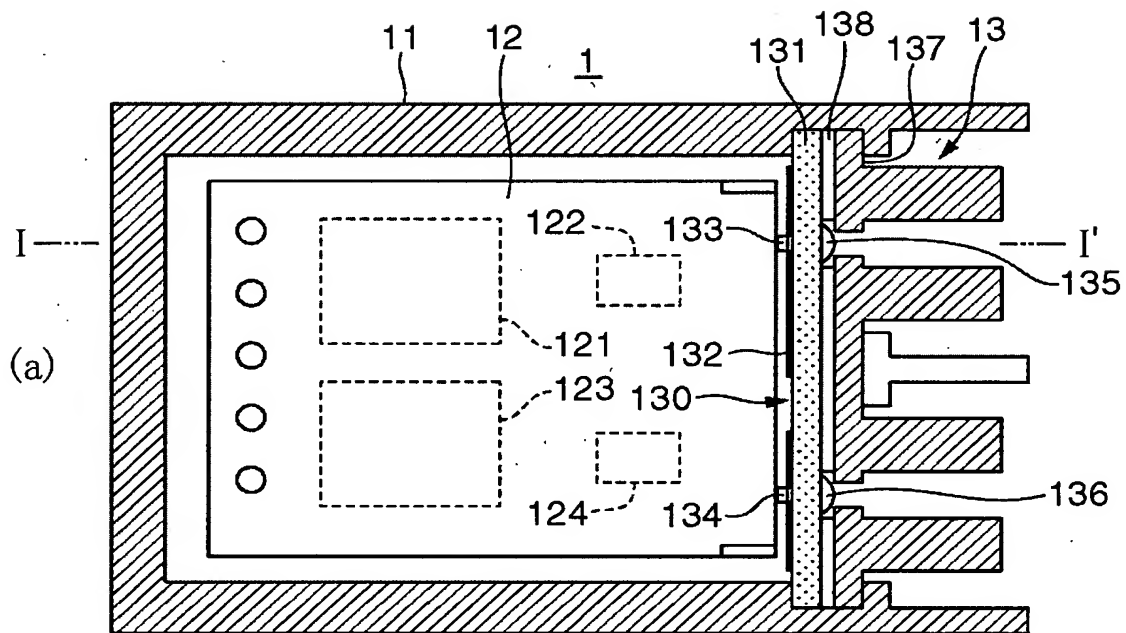
【符号の説明】

11…筐体、 131…ガラス基板、 133、134…光素子、 135、1

3 6 … 結合レンズ、 1 3 7 … 光ソケット、 2 0 0 … 光プラグ

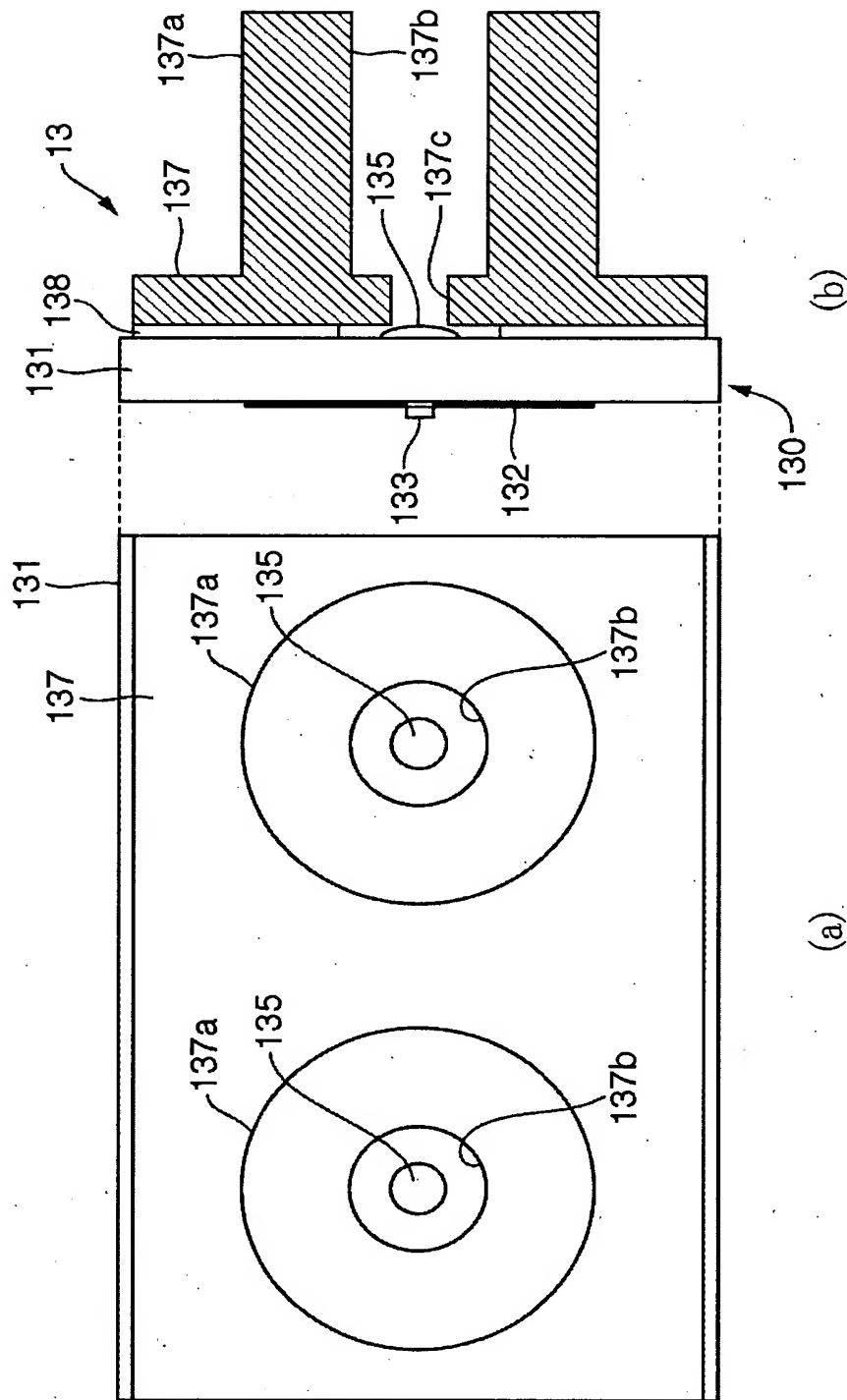
【書類名】 図面

【図 1】

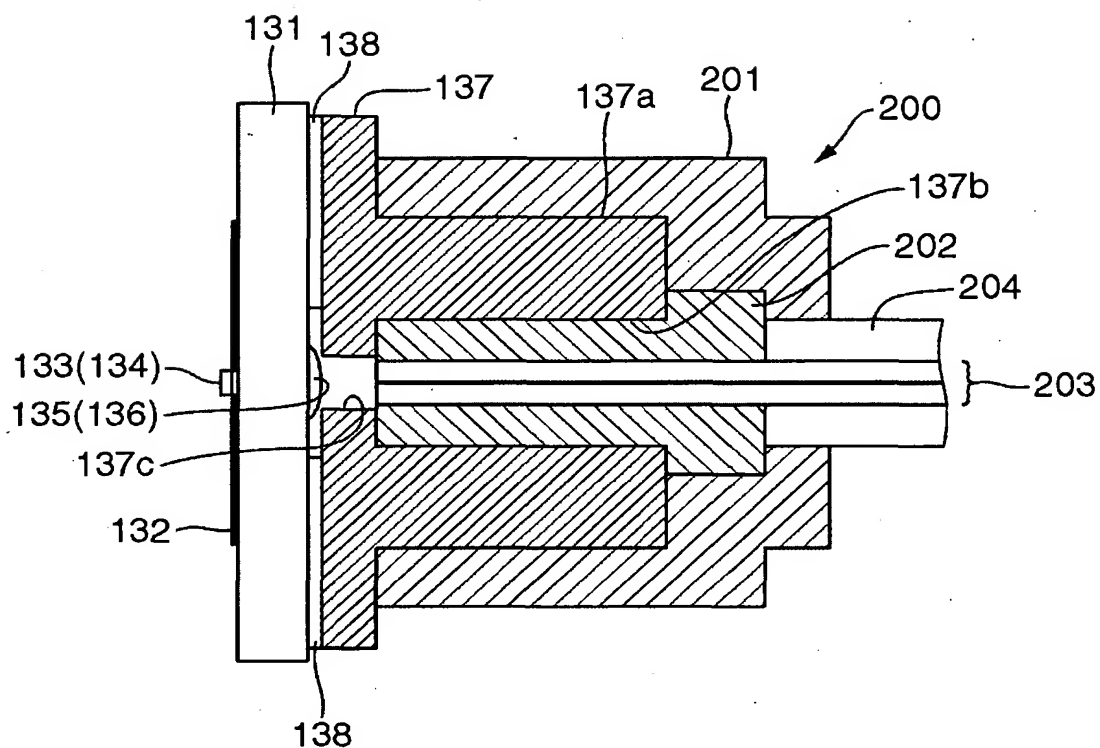


I-I' 断面

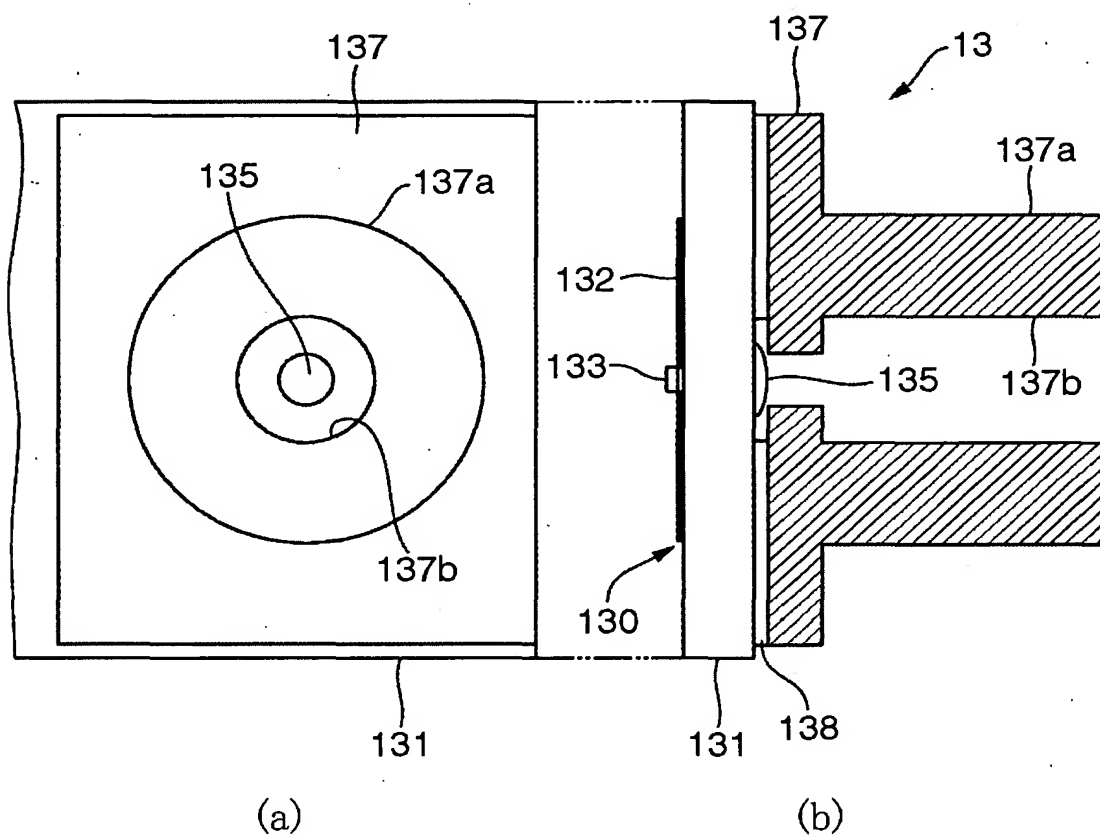
【図 2】



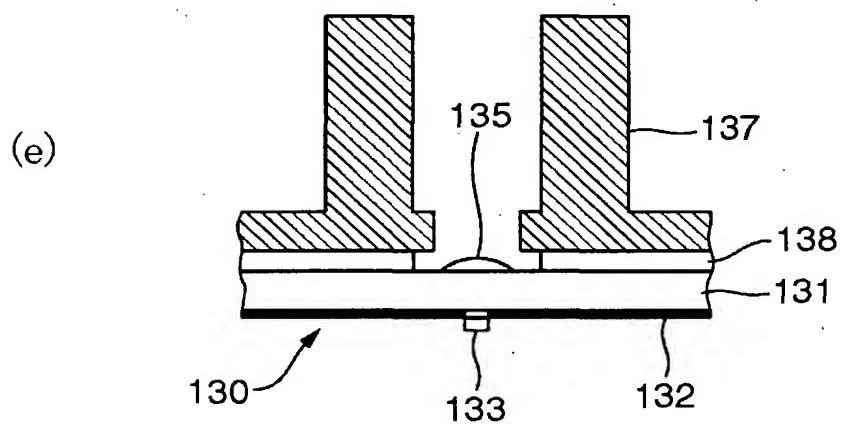
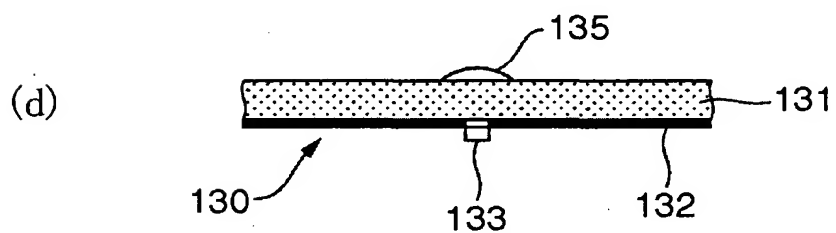
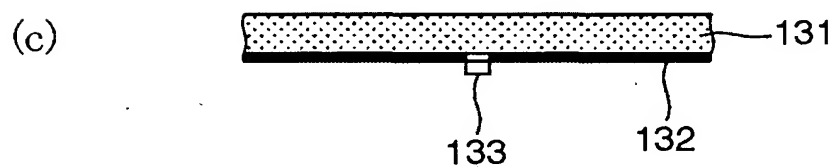
【図 3】



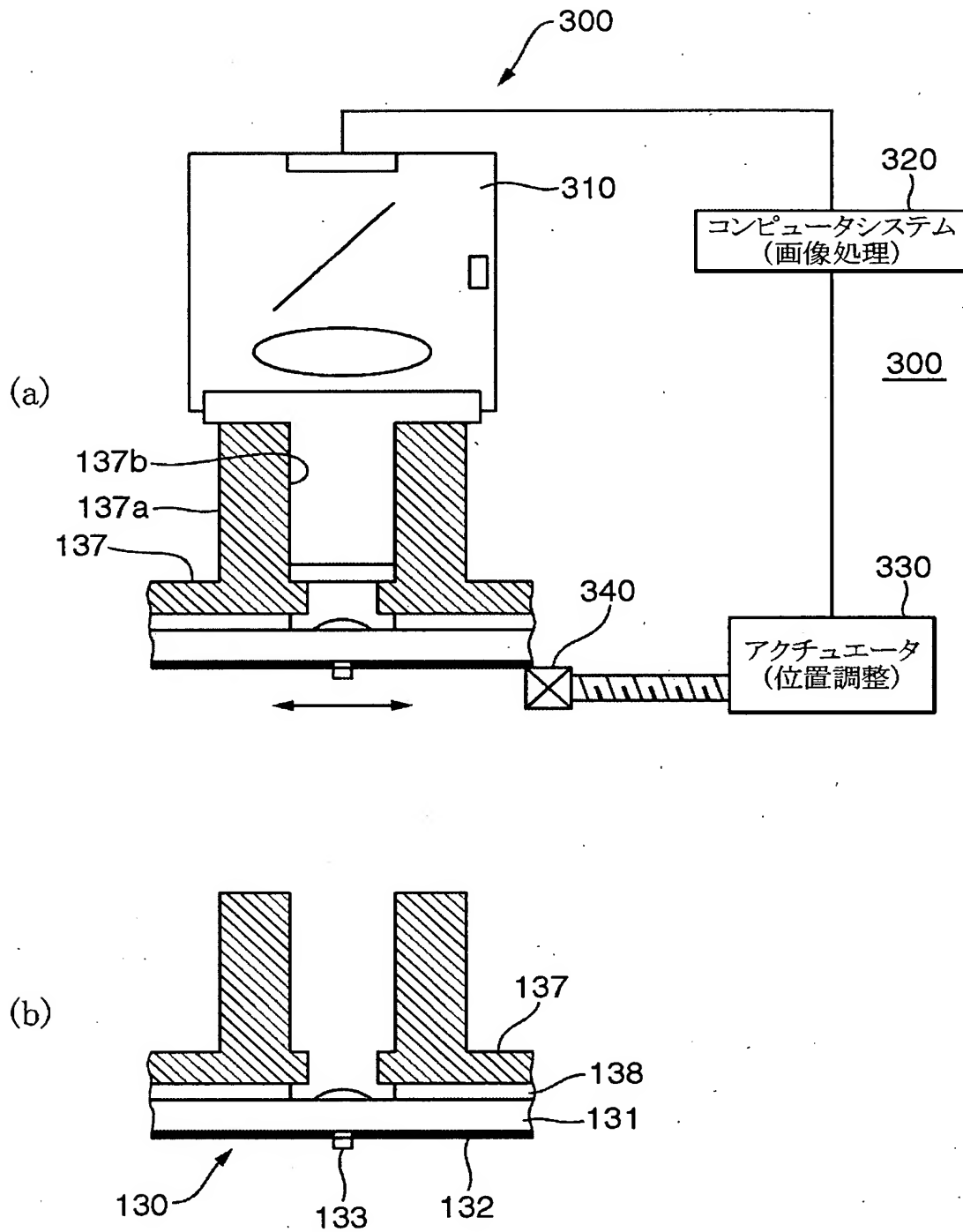
【図 4】



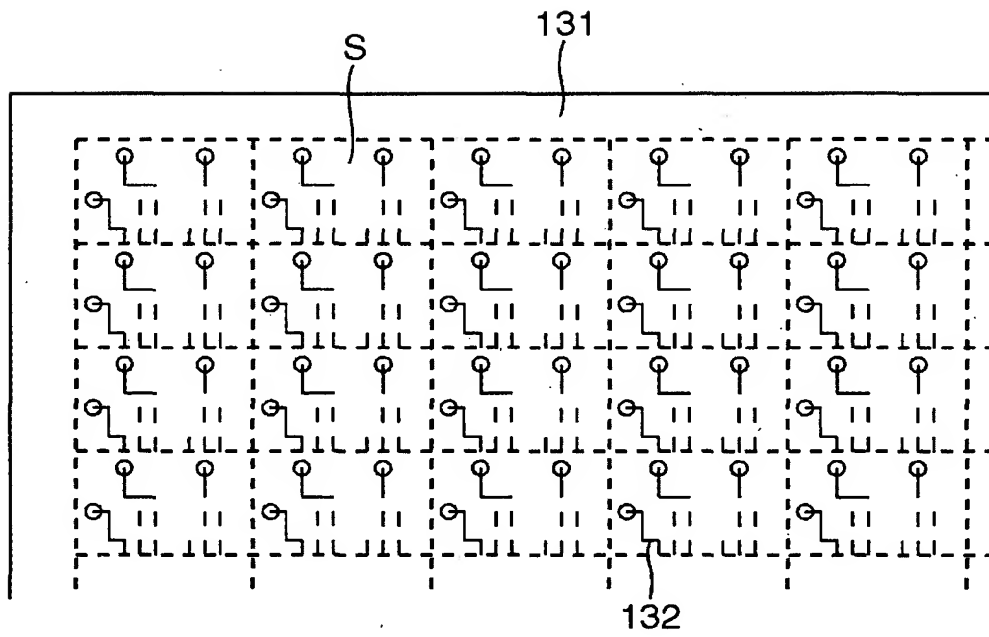
【图 5】



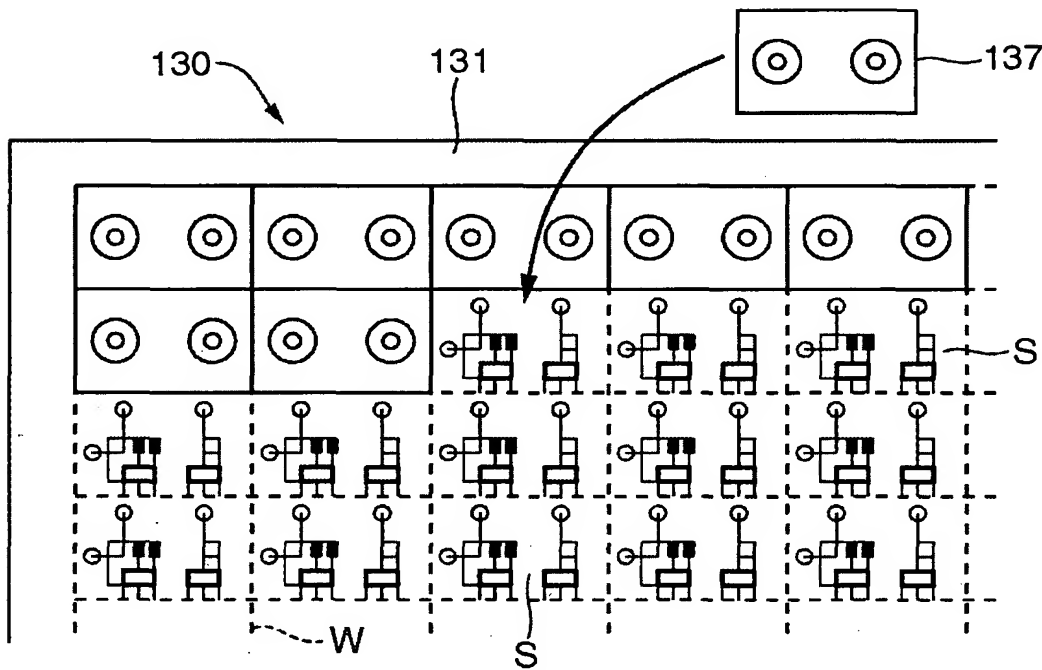
【図 6】



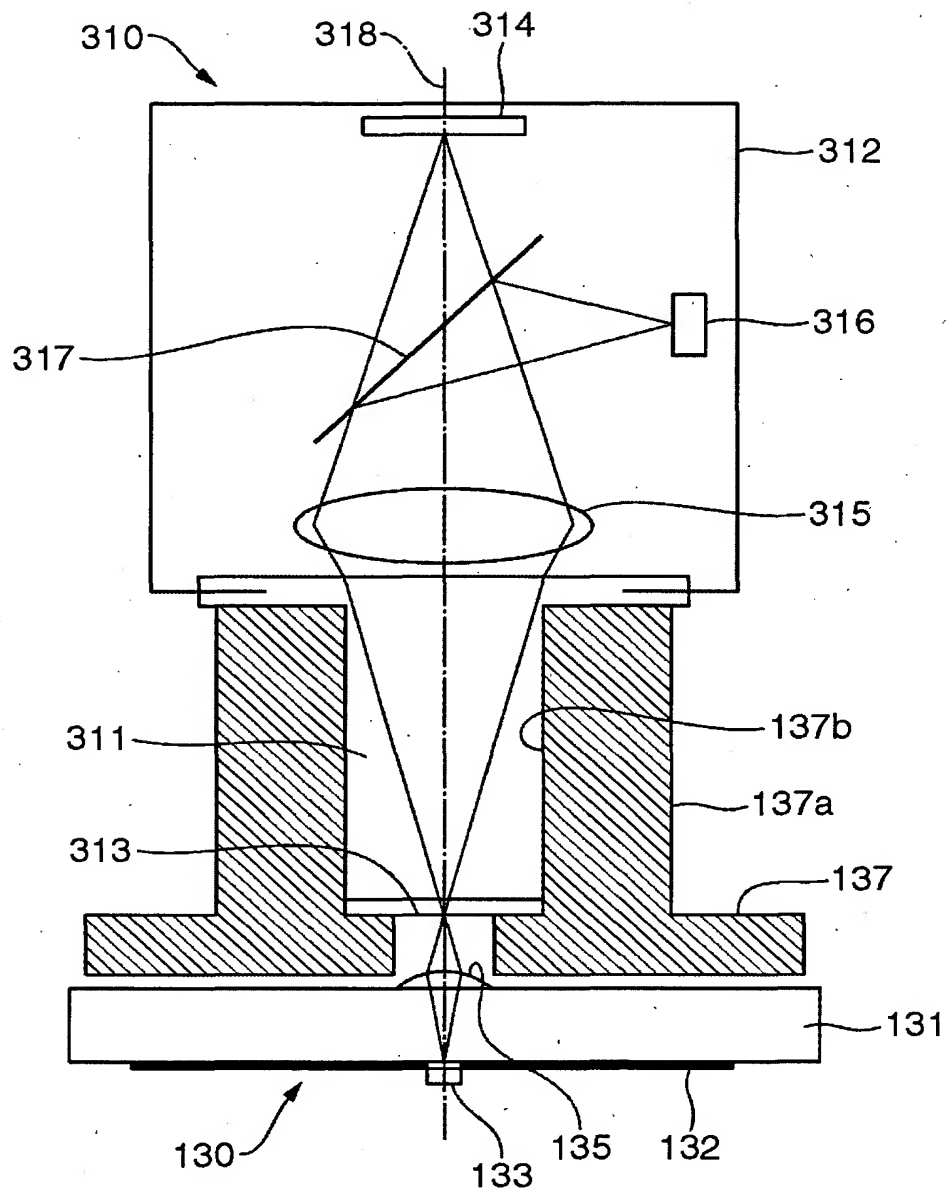
【図 7】



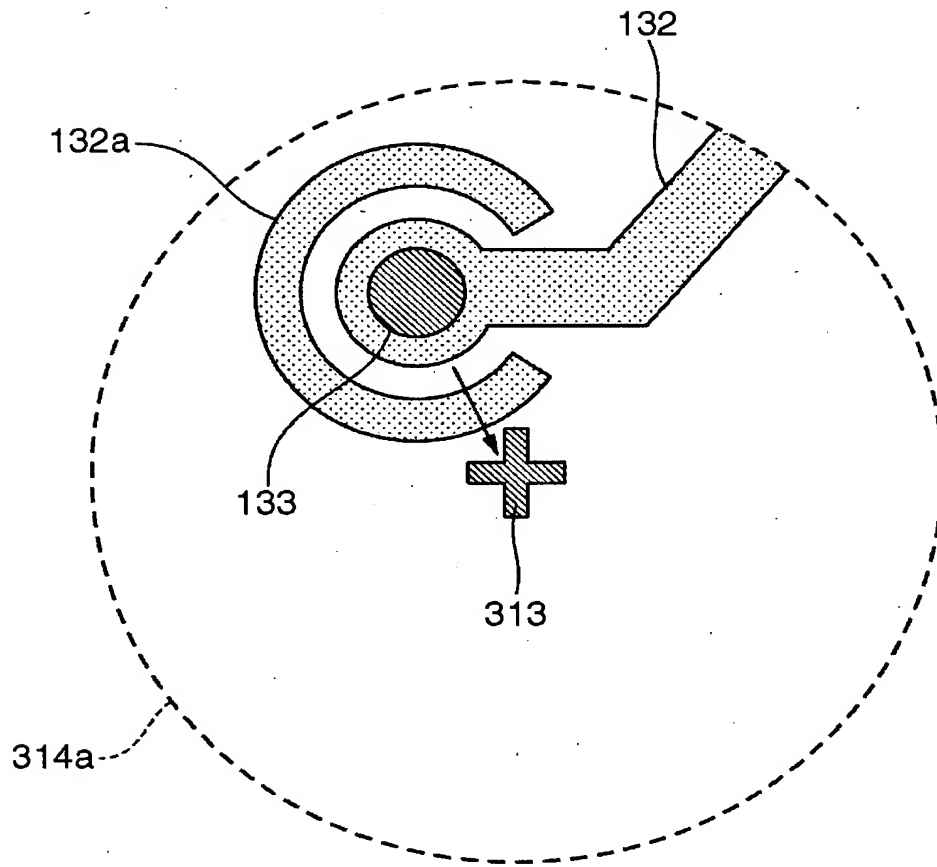
【図 8】



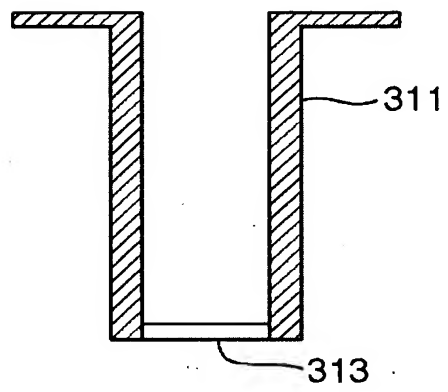
【図9】



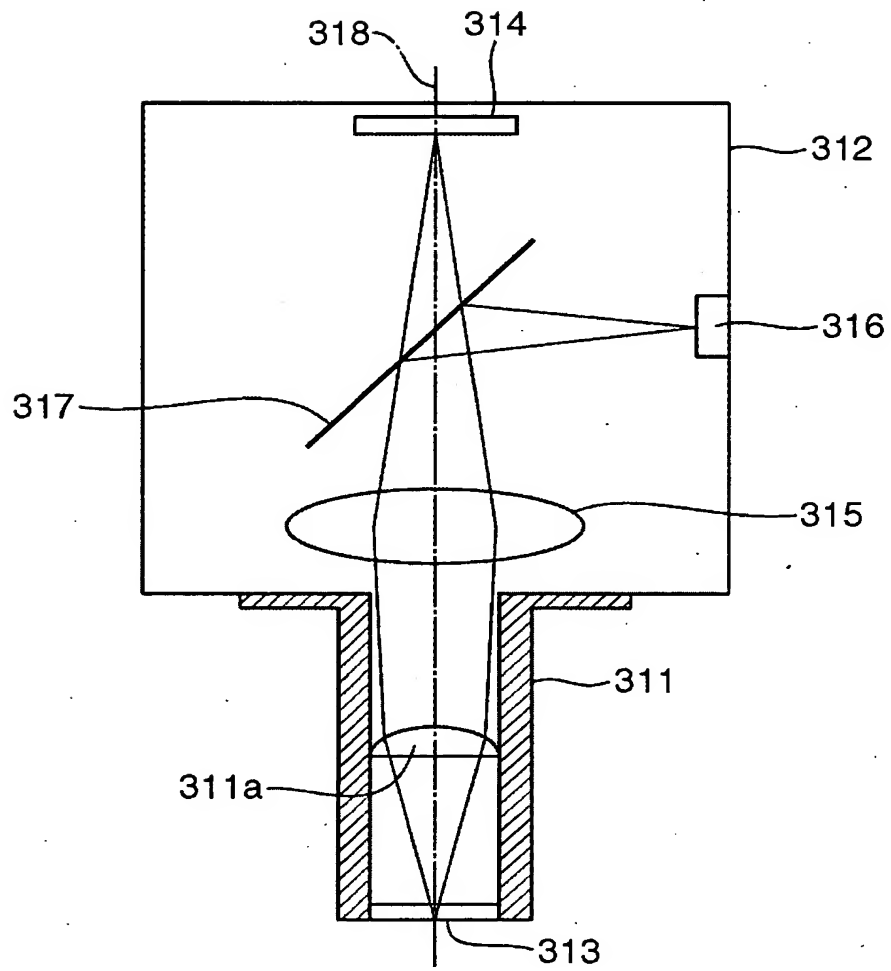
【図 10】



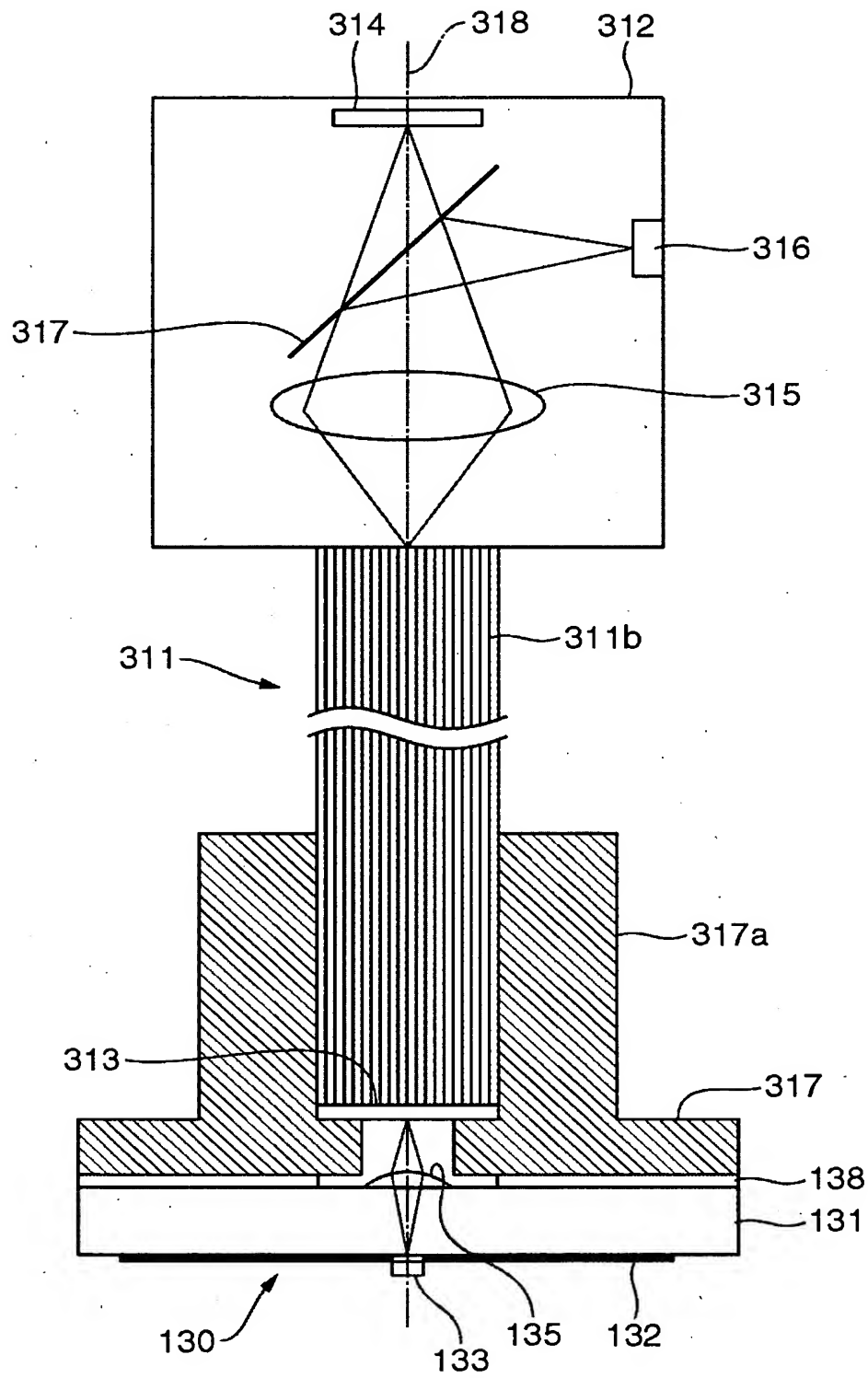
【図 11】



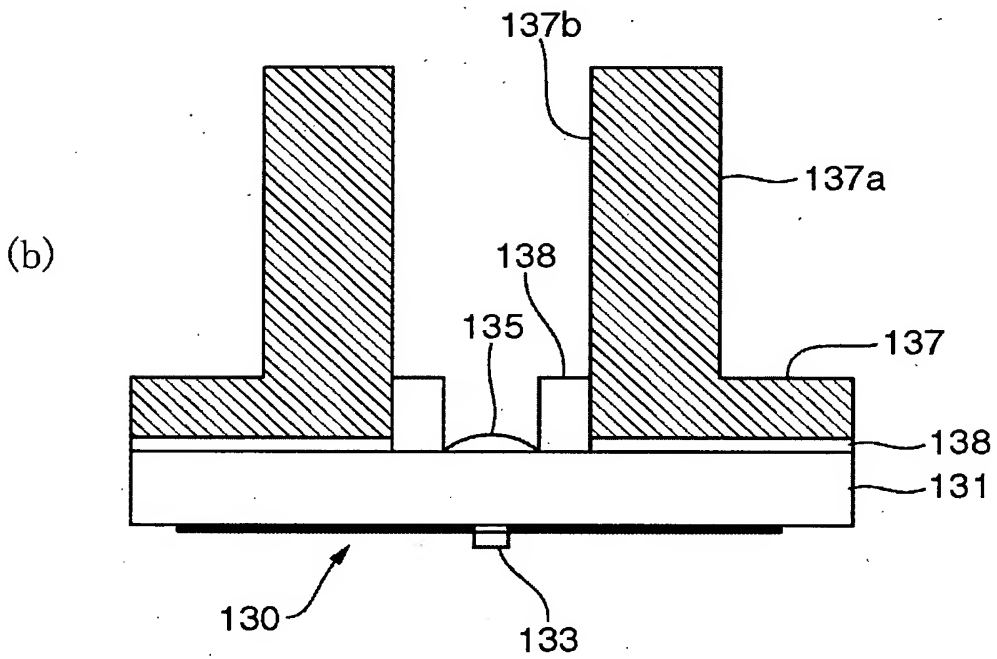
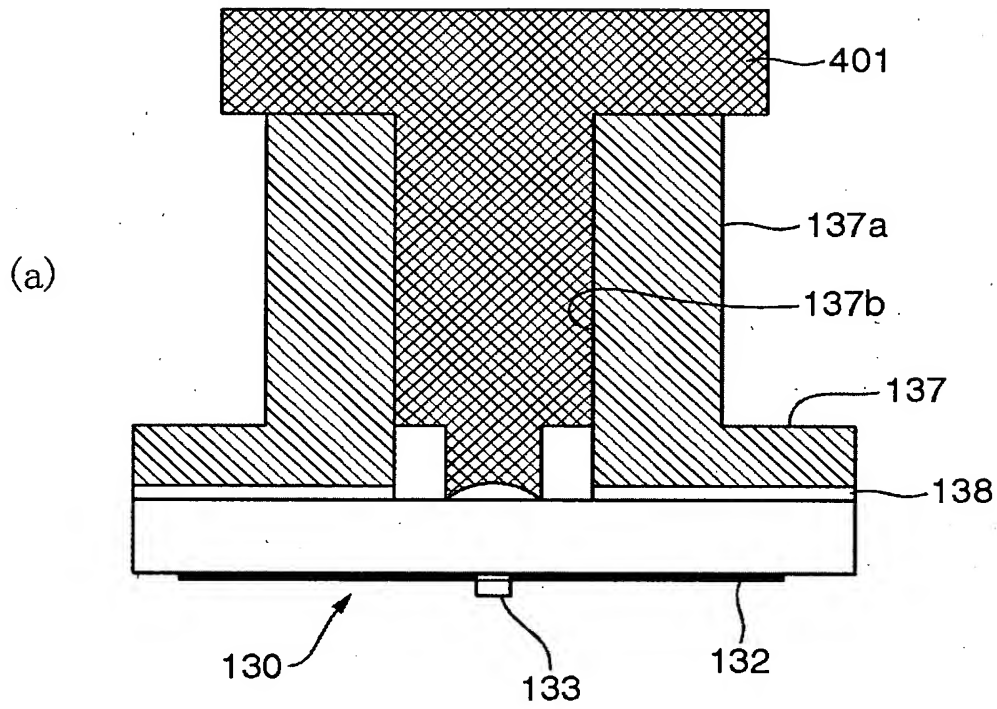
【図 12】



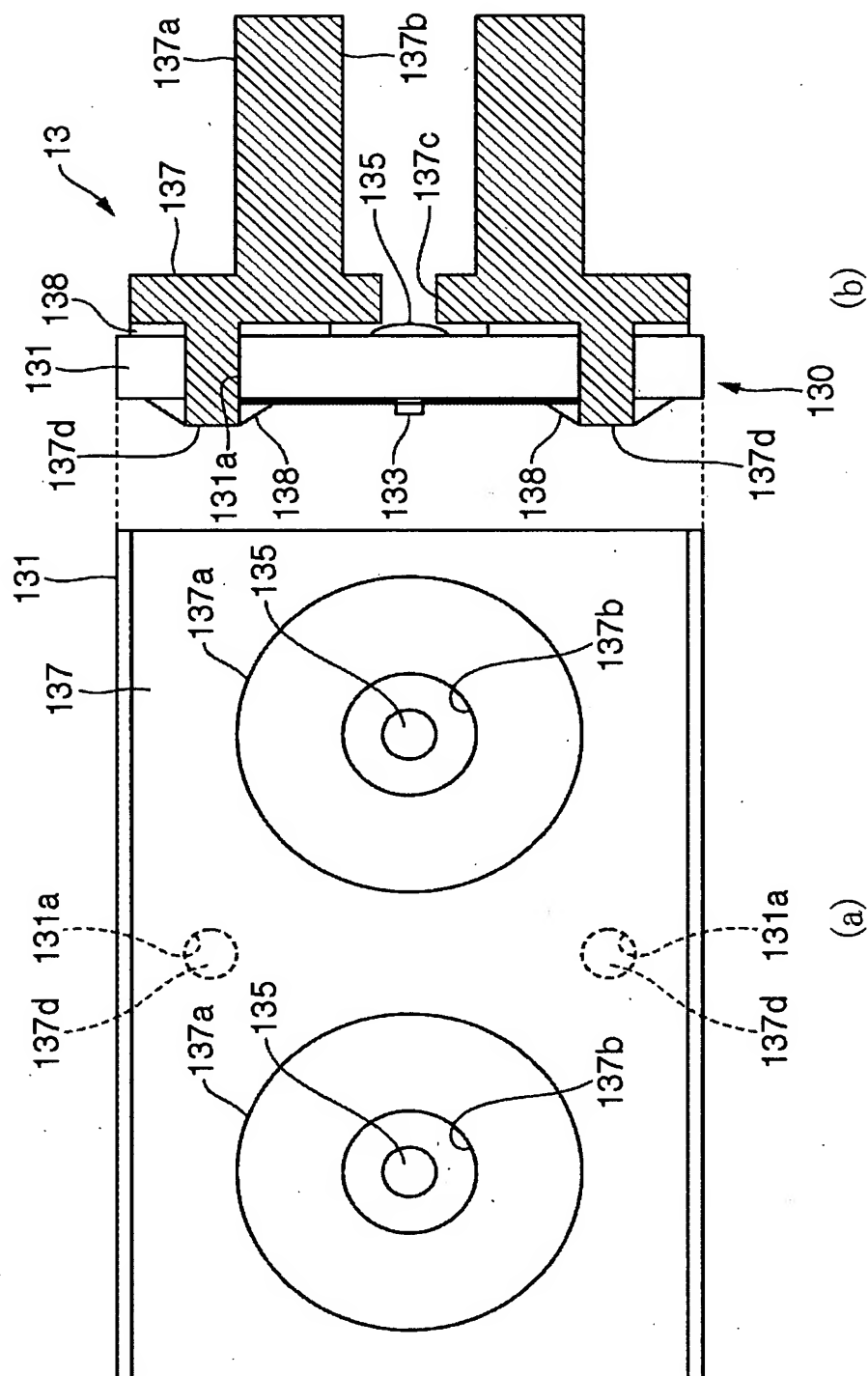
【図 13】



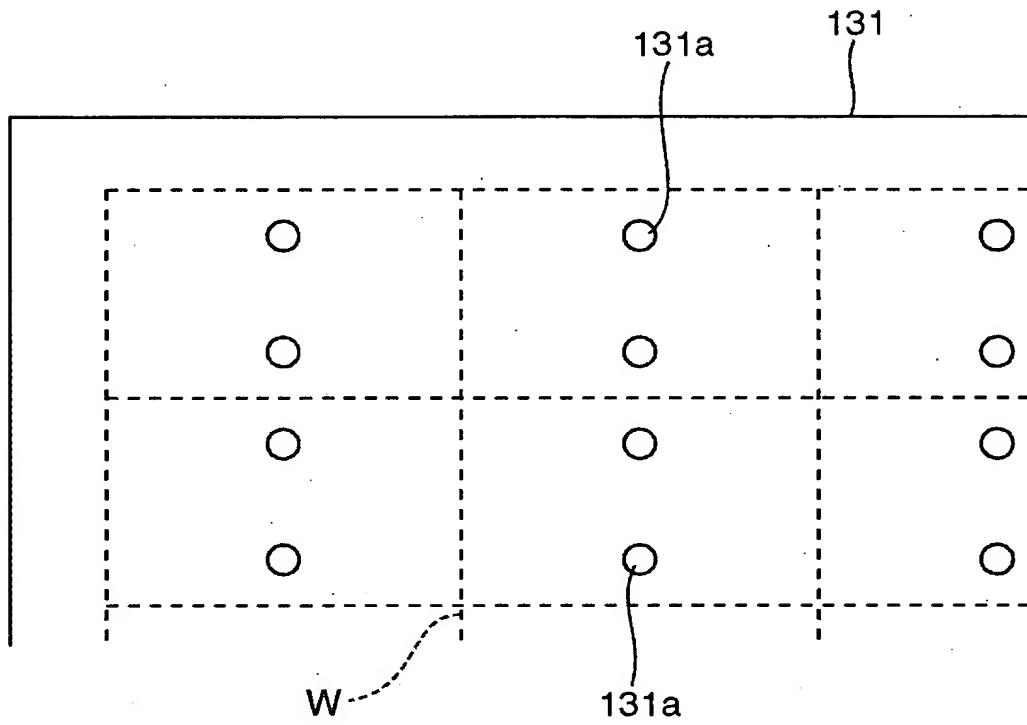
【図14】



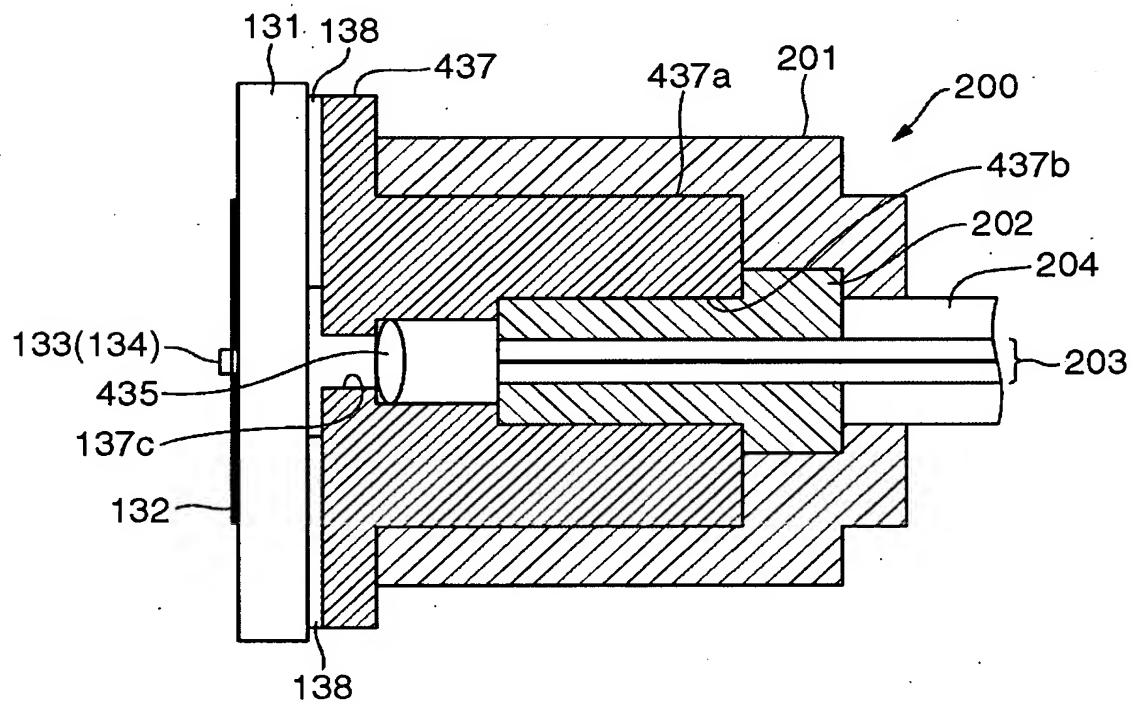
【图 1.5】



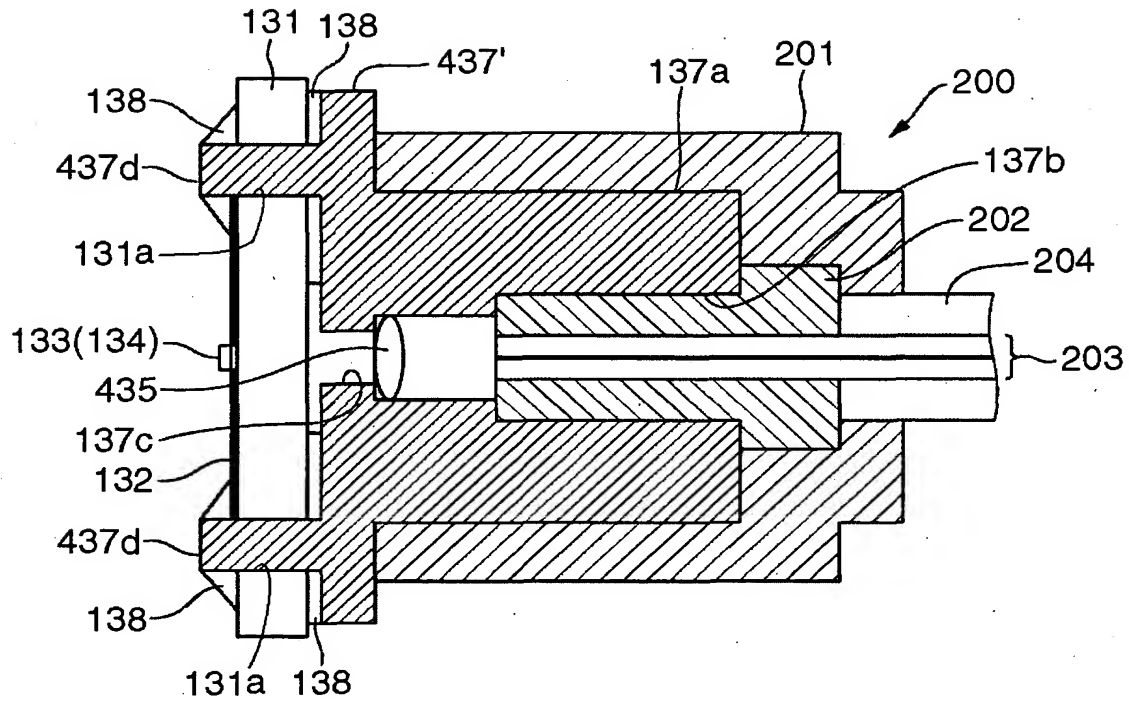
【図 16】



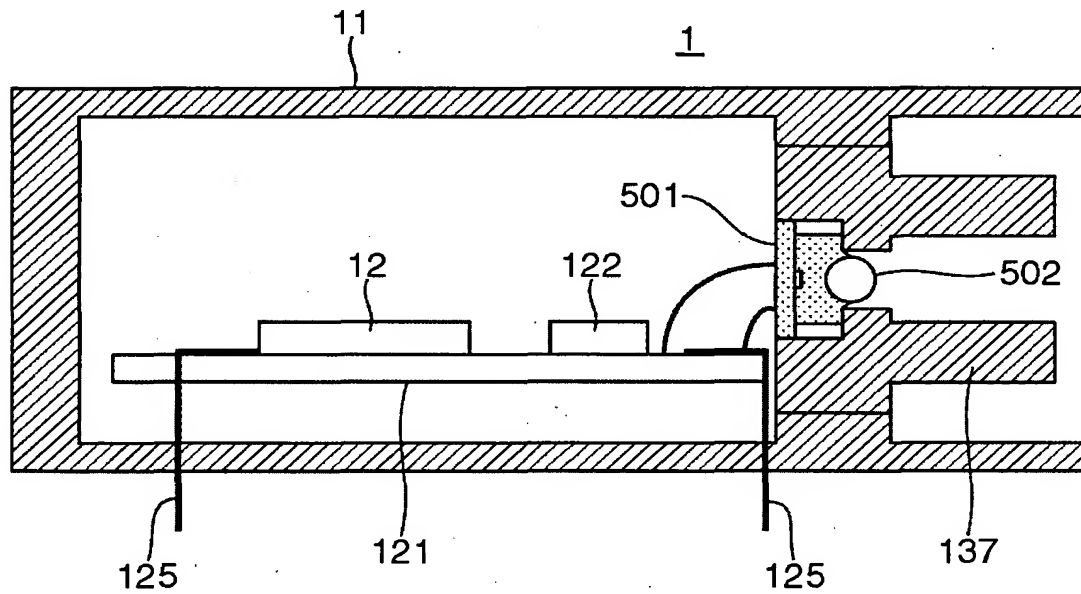
【図 17】



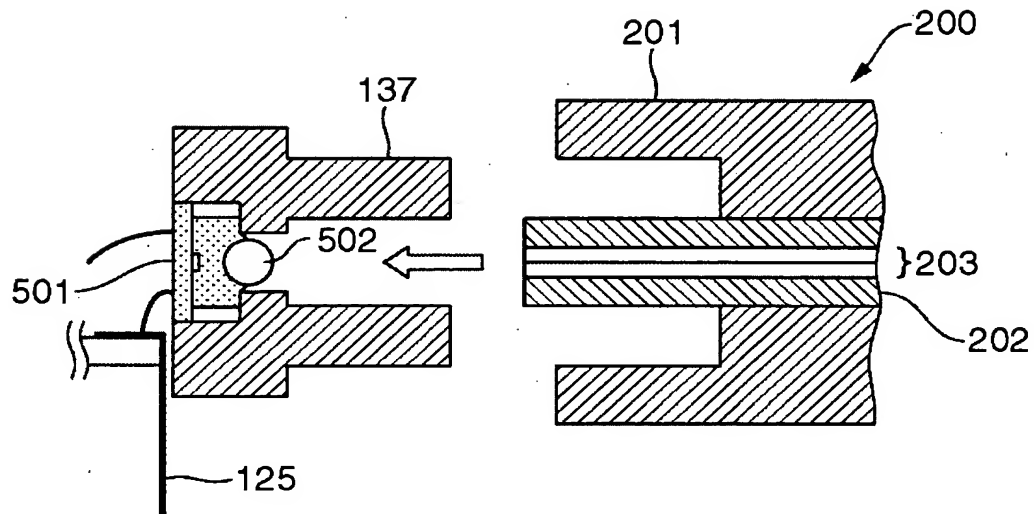
【図 18】



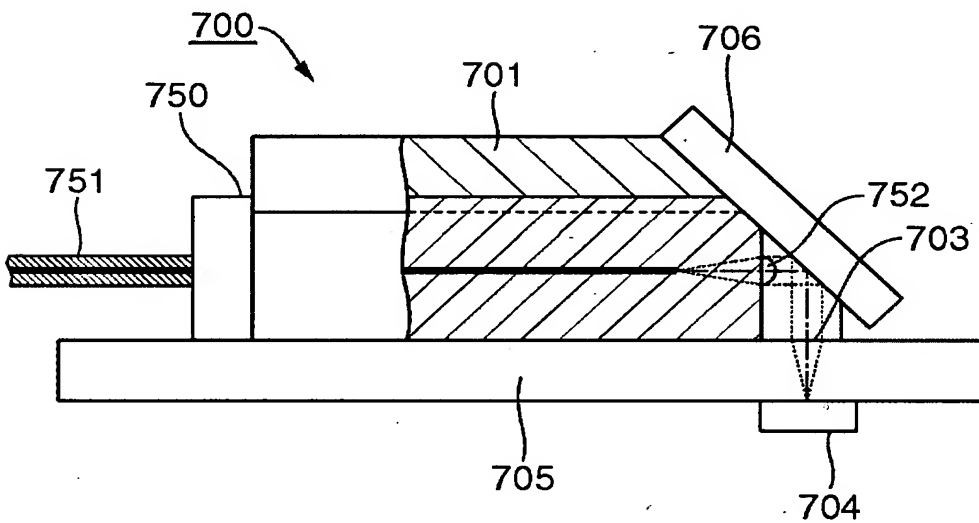
【図 19】



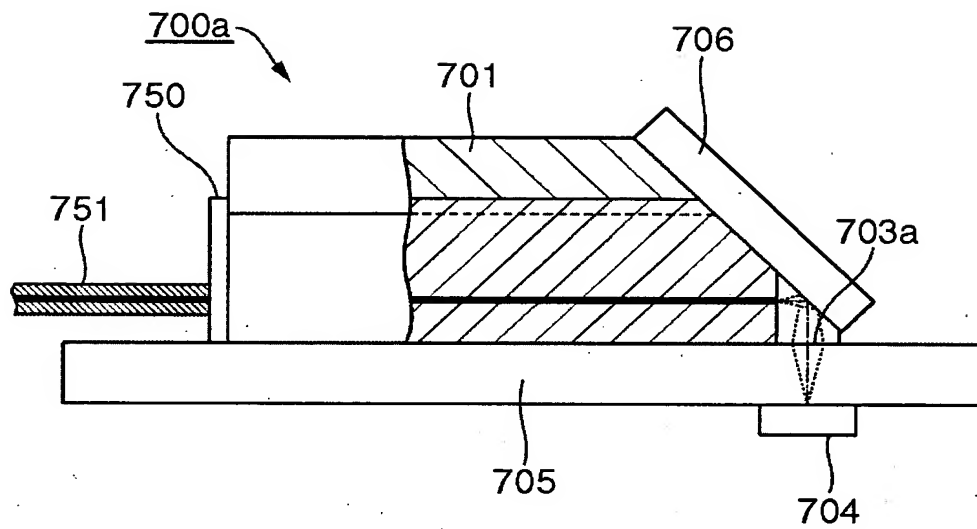
【図 20】



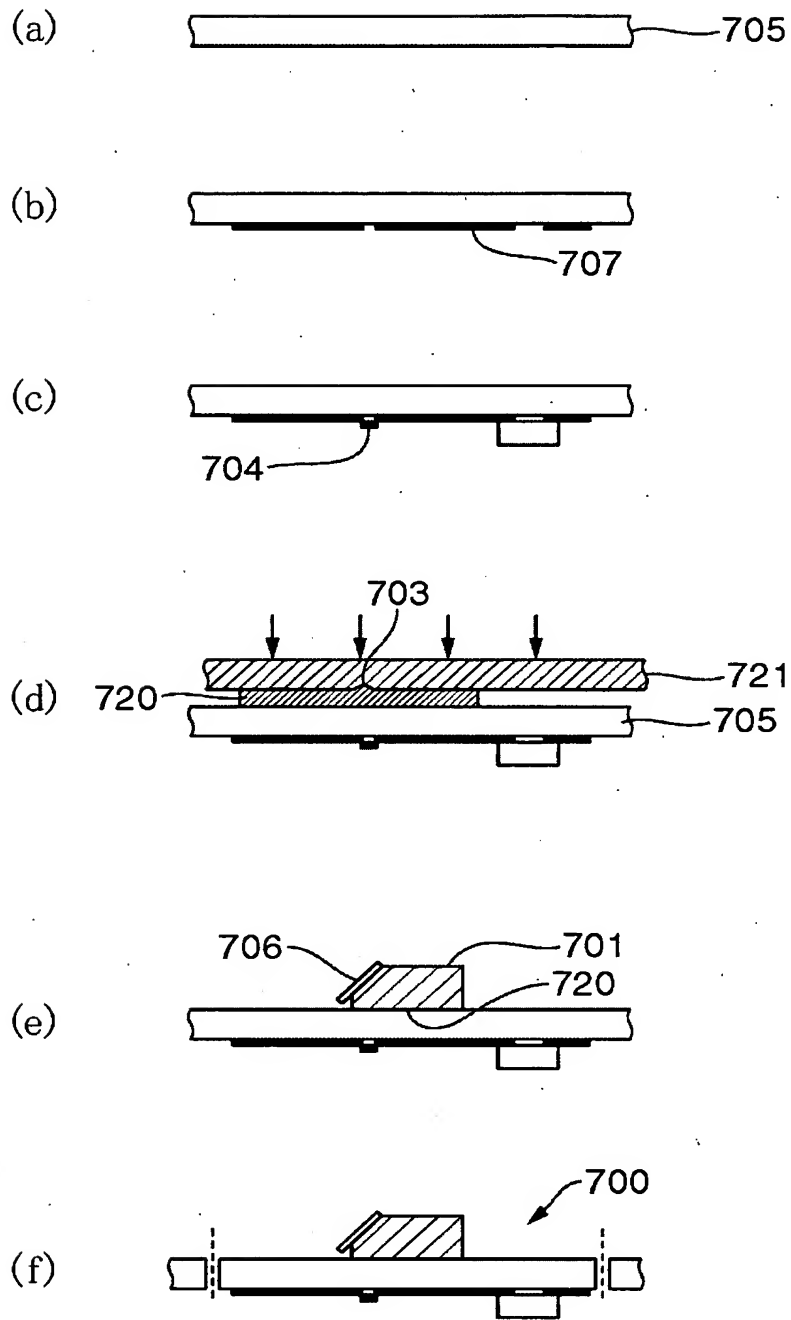
【図 21】



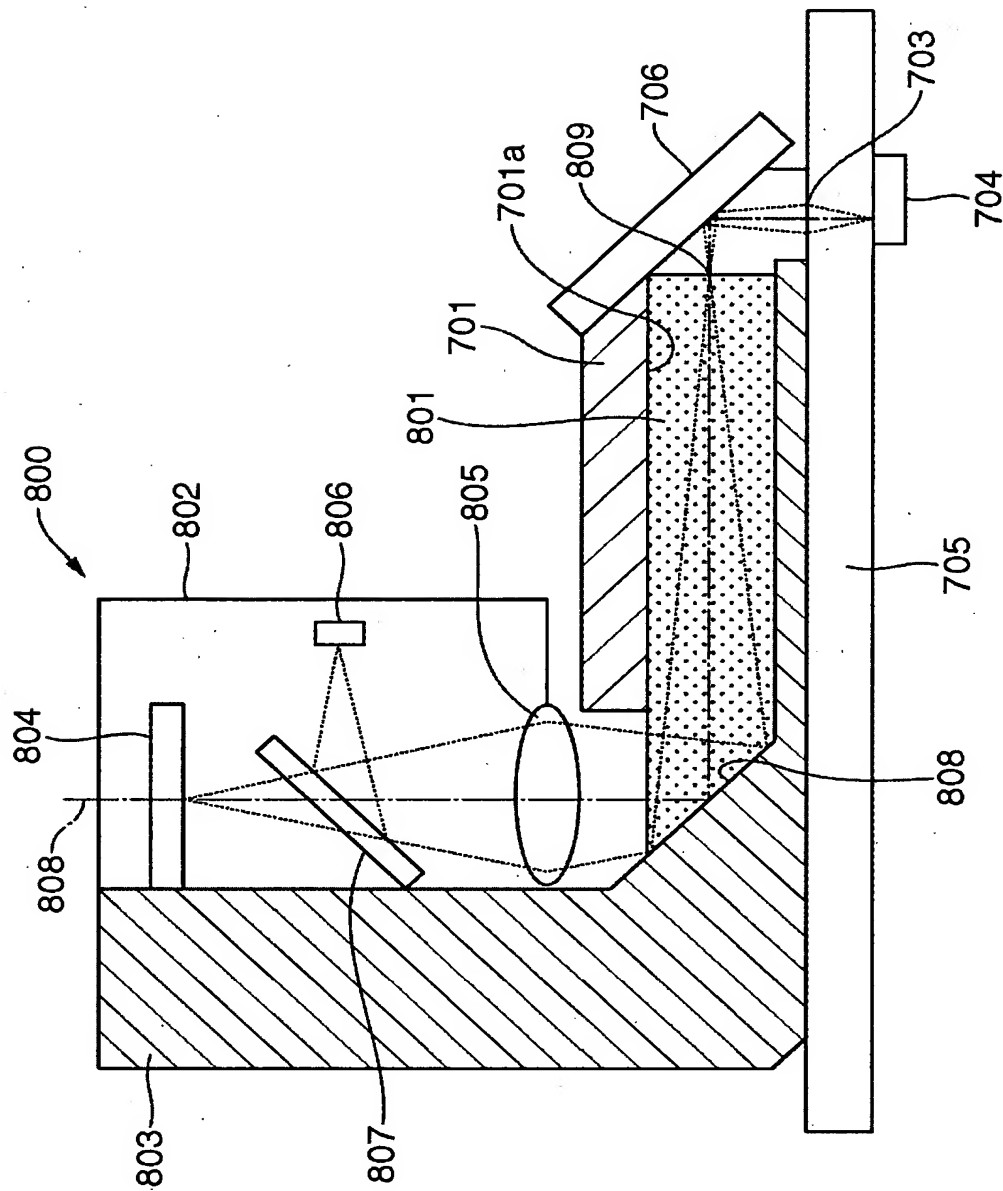
【図 22】



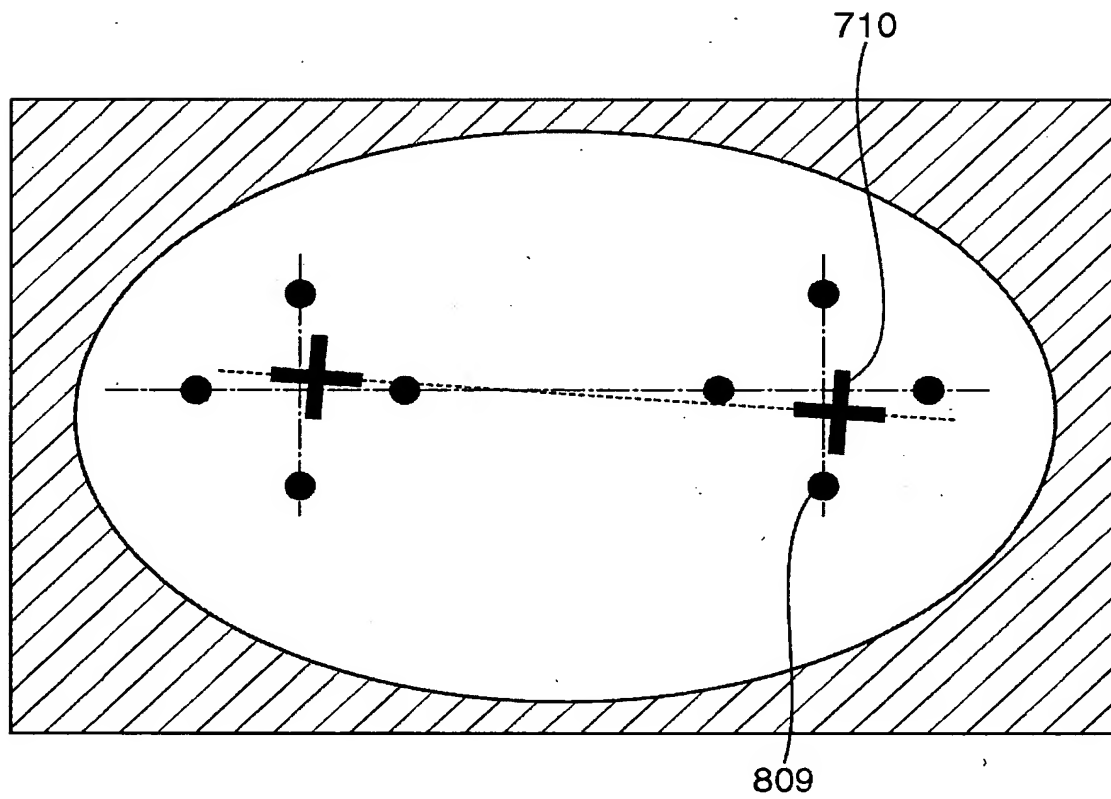
【図 23】



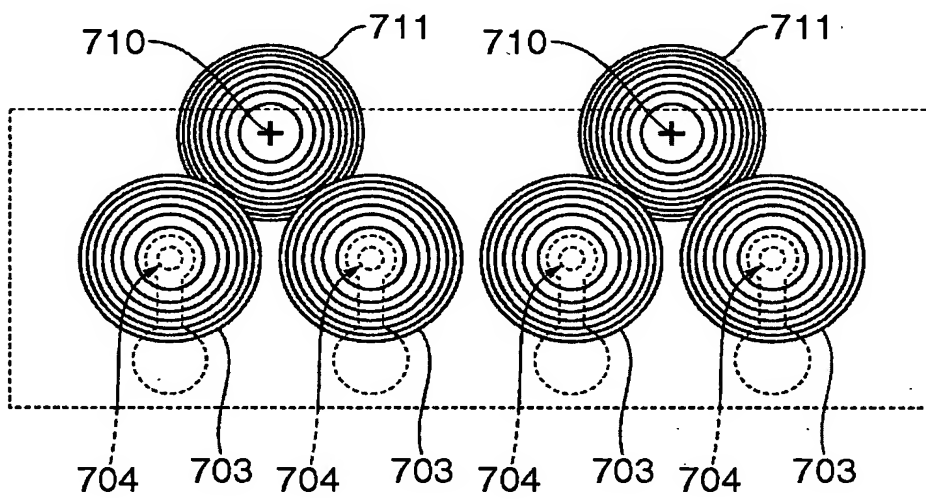
【図 24】



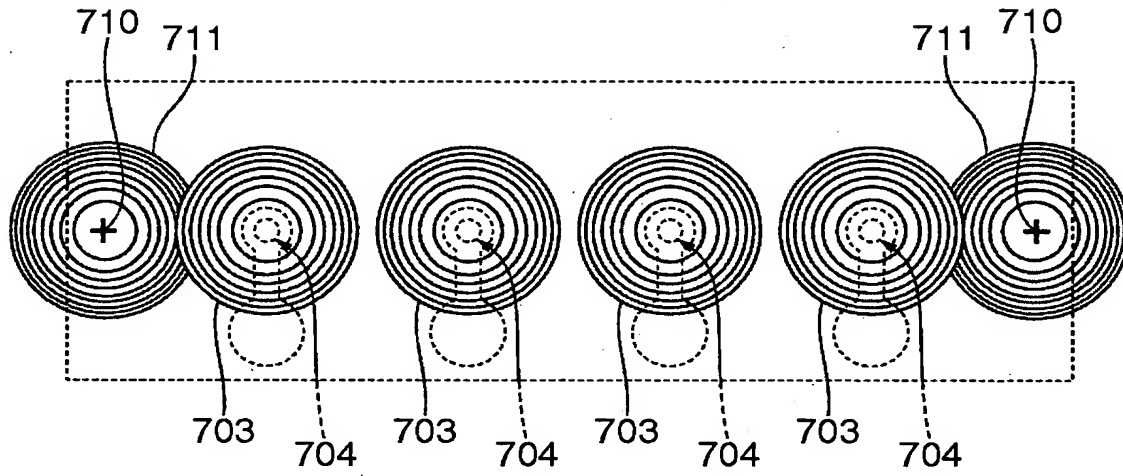
【図 25】



【図 26】



【図 27】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 製造工程をより簡易化することを可能とする光トランシーバの製造方法を提供する。

【解決手段】 本発明の光トランシーバの製造方法は、光ファイバの一端部を保持する光プラグを装着するための嵌合孔(137b)を備える光ソケット(137)とこの光ソケット(137)と共に組み立てられる組立対象体(130)とを合わせる工程と、光ソケット(137)の嵌合孔(137b)に組立対象体(130)を撮影する光ヘッド(310)を装着し、嵌合孔(137b)に露出する組立対象体(130)の画像と当該撮影画面内の基準位置情報とを得る工程と、組立対象体(130)の画像と基準位置情報とのずれを検出する工程と、上記ずれに基づいて光ソケット(137)と組立対象体(130)とを相対的に移動して上記ずれを減少する工程と、組立対象体(130)と光ソケット(137)とを固定する工程と、を含む。

【選択図】 図 6

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2003-029990
受付番号	50300194111
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0090
作成日	平成15年 2月12日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成15年 2月 6日
【特許出願人】	
【識別番号】	000002369
【住所又は居所】	東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
【氏名又は名称】	セイコーエプソン株式会社
【代理人】	申請人
【識別番号】	100079108
【住所又は居所】	東京都港区虎ノ門3-5-1 3.7 森ビル8階 TMI 総合法律事務所
【氏名又は名称】	稲葉 良幸
【選任した代理人】	
【識別番号】	100080953
【住所又は居所】	東京都港区虎ノ門3-5-1 3.7 森ビル8階 TMI 総合法律事務所
【氏名又は名称】	田中 克郎
【選任した代理人】	
【識別番号】	100093861
【住所又は居所】	東京都港区虎ノ門3丁目5番1号 3.7 森ビル8 03号 TMI 総合法律事務所
【氏名又は名称】	大賀 眞司

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名 セイコーエプソン株式会社